



2025年3月期 通期

決算説明資料

2025年5月15日

Mipox株式会社（マイボックス）

証券コード 5381

イノベーションに 磨きをかける。

イノベーションに磨きをかける。

最先端を研ぎ澄ます。

次の100年を切り開き、世界の常識を塗り替える。

日本には「つゆはらい」という言葉があります。

行列の先を行って障害を取り払うこと。

人々を先導すること。

転じて、何かを最初に行うこと。

お客様が進む未来の先に立ち塞がる課題を、先回りして取り除いておく。

世の中に横たわる課題に、まだ来ない誰かが躓かないように解決しておく。

100年にわたり「塗る・切る・磨く」ソリューションを提供してきた

私たちの仕事は、お客様と社会の行く先に磨きをかけること。

そして皆さんと切磋琢磨しながら、

私たち自身の技術にも磨きをかけることに他なりません。

これからの100年も、

未来が、眩しく光輝くように

私たちは、強く優しく磨き続けます。

mipox

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期
通期実績

FY2025 Full Year Financial Results

03

2026年3月期
業績見通し

FY2026 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

会 社 名	Mipox（マイボックス）株式会社
英 文 名	Mipox Corporation
創 業	大正14年（1925）年11月21日
設 立	昭和16年（1941）年12月12日
代 表 者	代表取締役社長 渡邊 淳
本店・本社	〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18
株式市場名	東京証券取引所 スタンダード
証券コード	5381

【経営方針】

付加価値向上

エンジニアリング
アプローチによる
製品事業の付加価値向上

事業転換

受託事業から
エンジニアリング
サービス事業への転換

経営基盤の整備

早い変化と
多様性に対応できる
経営基盤の整備



mipox

Ref Lite
Color Your Style.

MISUMI

Nikken

スガ コーディングス

OOKUBO IRON-WORK

thomas

「塗る、切る、磨く」を極めた技術力

創業から続く箔の製造技術を応用することで「塗る」「切る」「磨く」技術をコアにした事業を展開した企業です。

コア技術を組み合わせ、お客様の成功のための付加価値を創造するための製品とサービスを提供します。



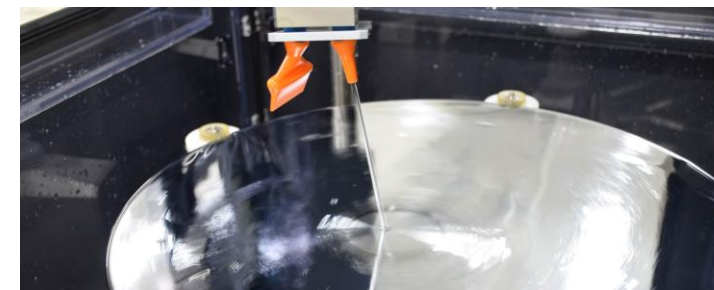
塗る Coating

PETフィルム、銅箔、織布、紙等の基材に、調合した樹脂等の塗料を均一に塗布。自社製品である研磨材や反射材だけでなく、保有する複数の塗工機によって要望に合わせた機能性フィルムの製造も実現。



切る Slitting

「塗る」ことで出来た製品を希望のサイズに裁断（スリット）。高精密さが求められるハードディスク向け研磨フィルムの製造で培った技術によって、裁断が困難といわれている素材でも精度の高い切り口と巻き上げを実現し、高品質の製品を提供。



磨く Polishing

徹底的な顧客視点を持った製品開発のために自社の研磨材と独自の研磨装置で研磨プロセスの研究を積み重ねる。ハイテク分野で培った高精度研磨加工技術で次世代半導体ウェーハの研磨にも挑戦し、研磨市場に於けるプロフェッショナルを目指す。

拠点開設	事業領域	売上高（百万円）	トピックス
1925 東京都京橋区にて設立	製品事業 受託事業		顔料と色箔の輸入業者としてドイツ資本により設立（独逸顔料合名会社）
1981			日本マイクロコーティング㈱へ商号変更
2001		6,858	JASDAQ店頭市場に上場
2002		4,439	
2003		4,949	
2004		7,197	
2005		10,799	
2006		8,966	
2007		8,329	
2008		6,083	
2009		3,238	2009年3月期 渡邊淳が代表取締役社長に就任（現代表）
2010		3,013	受託事業強化
2011		3,157	
2012 インド、中国（上海）		3,045	
2013 フィリピン		2,815 594 3,409	Mipox㈱へ商号変更、本社を東京都立川市へ移転
2014 台湾		3,202 558 3,760	
2015 京都府京都市		3,606 379 3,985	日本レフライト工業㈱を子会社化、Mipox Kyoto㈱を設立
2016 ベトナム、広島県福山市		3,930 274 4,204	日本研紙㈱を子会社化
2017		6,219 190 6,410	Mipox Kyoto㈱を吸収合併
2018		7,009 816 7,826	
2019		7,083 474 7,558	日本研紙㈱の営業機能を統合
2020 中国（深セン）		6,832 506 7,338	Ref Liteのリブランド
2021 広島県呉市		6,416 944 7,361	本店を山梨県北杜市へ移転、日本研紙㈱を吸収合併、オムニ・カーボナイト事業を吸収分割
2022 栃木県鹿沼市		7,570 2,879 10,449	ミスミ化学㈱を子会社化、本社を東京都四谷に移転
2023		7,948 2,080 10,029	本店本社を栃木県鹿沼市へ移転、㈱スガコーディングスの粉体塗装事業を譲受、(有)大久保鉄工所を子会社化
2024 熊本県熊本市、宮城県仙台市、石川県金沢市		7,618 1,735 9,354	インド工場を移転、thomas ㈱への出資
2025		9,956 1,215 11,172	創業100周年

製品事業

研磨材の製造・販売

売上高
構成比 **89%**

ハイテク
関連製品 **50%**

HDD関連、半導体、光ファイバー等
で使用される研磨材の製造・販売

一般研磨
関連製品 **39%**

自動車、鉄鋼関連等で使用される
研磨材の製造・販売

ハイテク
関連製品

半導体関連

光ファイバー
関連

HDD関連

自動車関連

鉄鋼関連

その他

一般研磨
関連製品

2025年3月期
売上高
11,172
百万円

国内外売上高比率（2025年3月期）

日本44%

海外56%

受託事業

顧客から材料の支給を受け
当社グループが保有する設備で受託加工

売上高
構成比 **11%**

受託塗布・
スリット **7%**

顧客からフィルムや塗料材等を預かり、
当社設備を使用して加工製造

受託研磨
加工 **4%**

半導体用途を中心にウェーハ等の材料
を預かり、当社の研磨材と設備を使用
して研磨加工

受託研磨加工

受託塗布・
スリット

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期
通期 実績

FY2025 Full Year Financial Results

03

2026年3月期
業績見通し

FY2026 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

(百万円)	リリース日	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
期初予想（A）	2024年5月15日	10,000	300	300	200
修正予想①（B）	2024年8月19日	10,000	700	800	600
修正予想②（C）	2024年11月14日	10,000	900	800	600
業績差異（D）	2025年5月15日	11,172	942	855	911
2024年3月期実績		9,354	▲442	▲186	▲408
増減額（D-C）		+1,172	+42	+55	+311
増減率		+11.7%	+4.7%	+6.9%	+52.0%

【コメント】

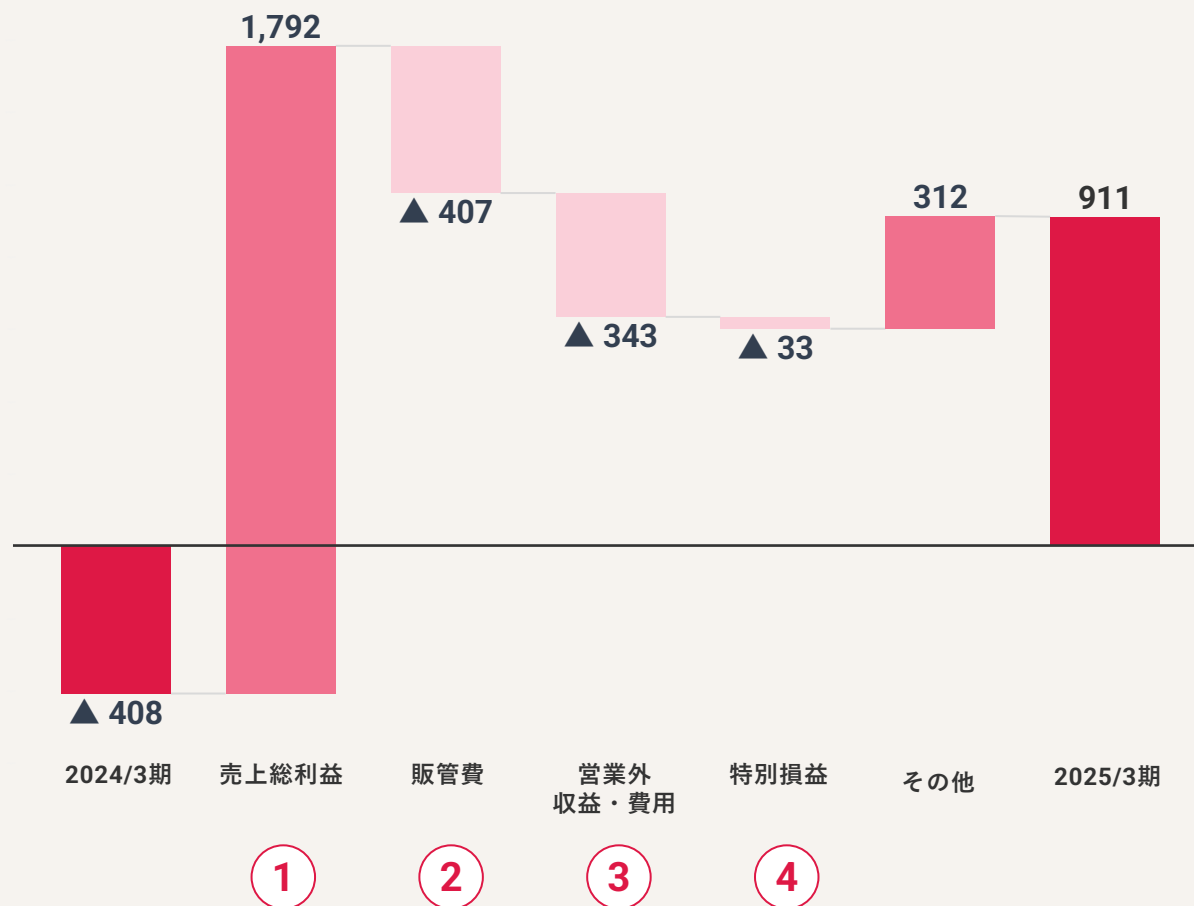
米国を中心とする光ネットワークインフラ整備や生成AI関連のデータネットワーク設備強化の影響により、HDDや光ファイバー、半導体関連のすべてのハイテク用途製品で、当初の見込みよりも売上高が高水準で推移いたしました。ハイテク関連製品は相対的に利益率が高い傾向にあり、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想より上回る結果となりました。

売上高が前年同期比で19.4%増加し、営業利益は黒字に転じました。製品事業ハイテク関連製品の売上高が増加したことが主要因で、利益率が大きく改善しました。

	2024/3期	2025/3期	前年同期比
(単位：百万円)			
売上高	9,354	11,172	19.4%
売上総利益	2,577	4,369	69.5%
販売費及び一般管理費	3,019	3,427	13.5%
営業利益	▲ 442	942	-
為替差損益	133	▲ 97	-
経常利益	▲ 186	855	-
親会社株主に帰属する当期純利益	▲ 408	911	-

※百万円未満切り捨て、業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

（単位：百万円）



利益増減要因

- ① 利益率が相対的に高い製品事業ハイテク関連製品の売上高の増加が主要因で、売上総利益が大幅に増加しました。
- ② 人件費および物流費を中心に販管費が増加しました。
- ③ 前期は為替差益を計上した一方、当期は円高による為替差損が生じました。また、前期は補助金収入がありましたが、当期では該当の営業外収益の発生はありませんでした。
- ④ 前期は関係会社清算益等がありましたが、当期は該当する特別損益は発生しませんでした。

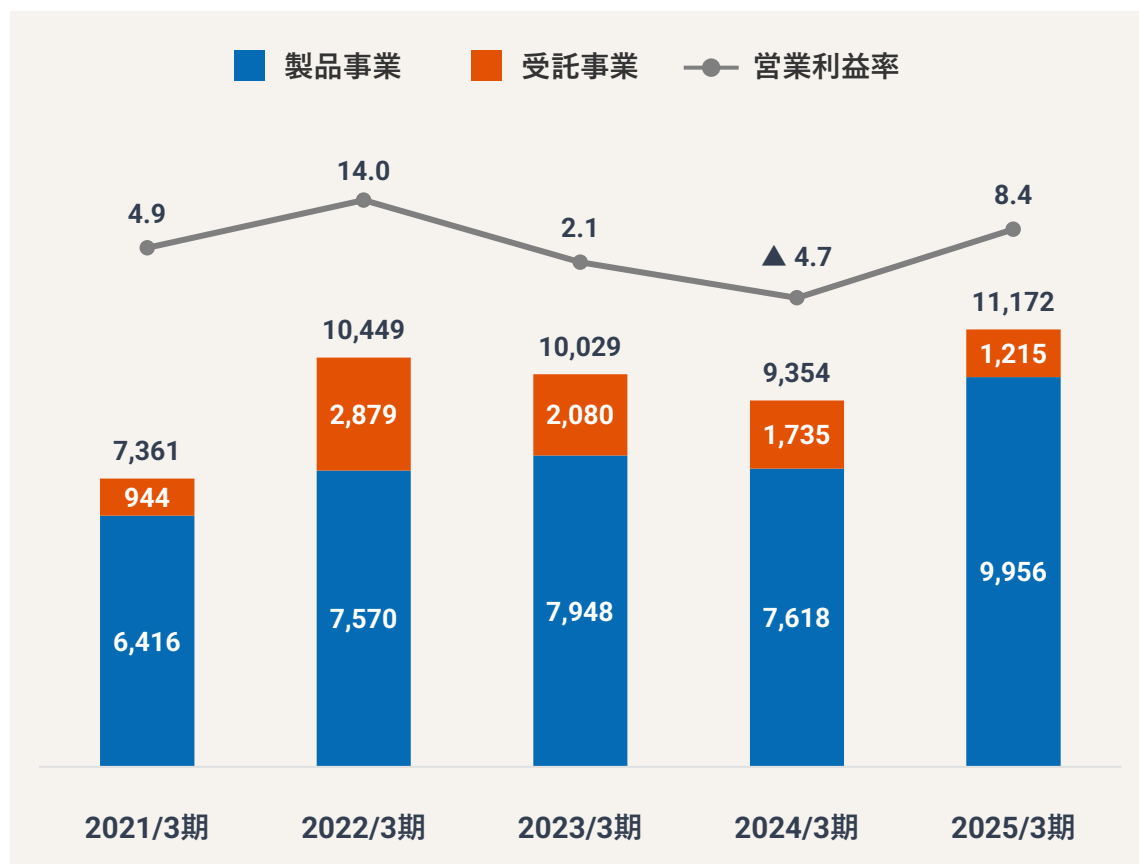
*増減算出後、百万円未満切捨て

02 通期業績推移（連結）

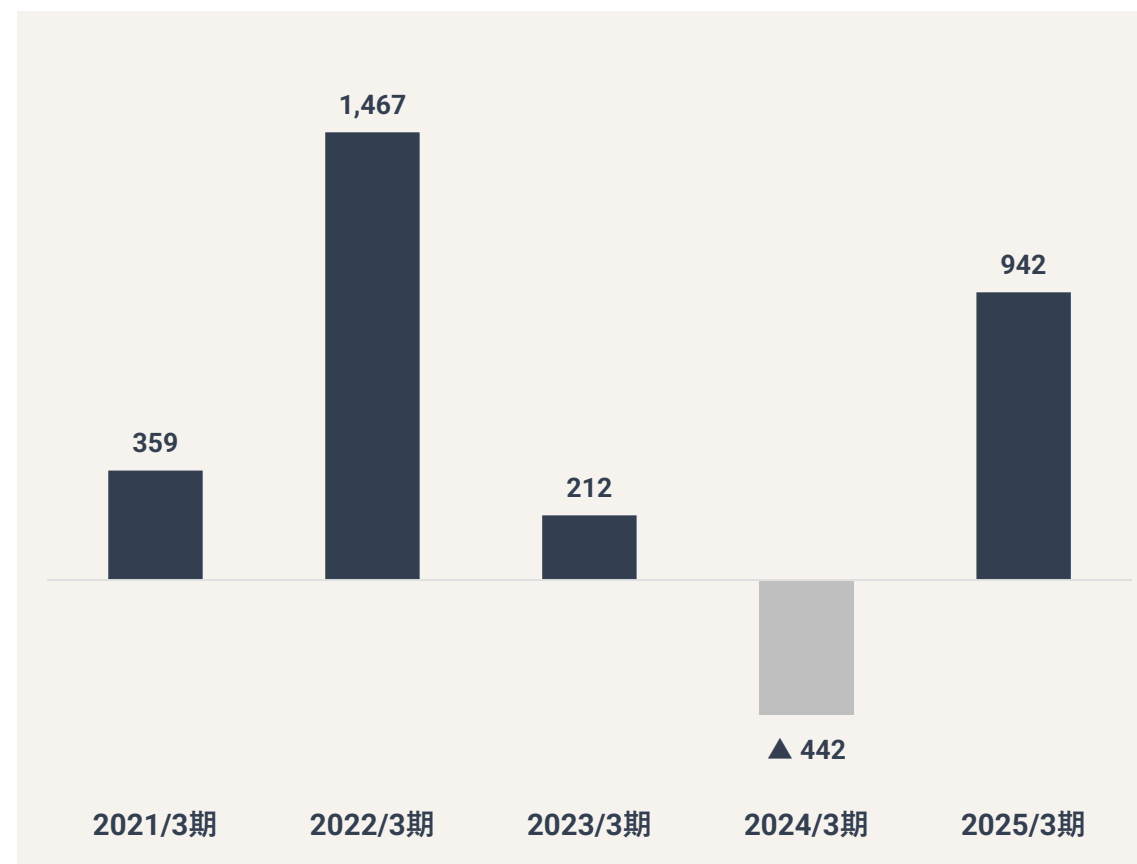
Mipox株式会社 2025年3月期 通期決算説明資料（証券コード5381）

製品事業の売上高が大幅に増加しました。特にハイテク関連製品の売上が好調であり、全体の営業利益増加を牽引しました。受託事業は売上が減少しセグメント利益は赤字となりましたが、全体では増収増益となりました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



営業利益（単位：百万円）



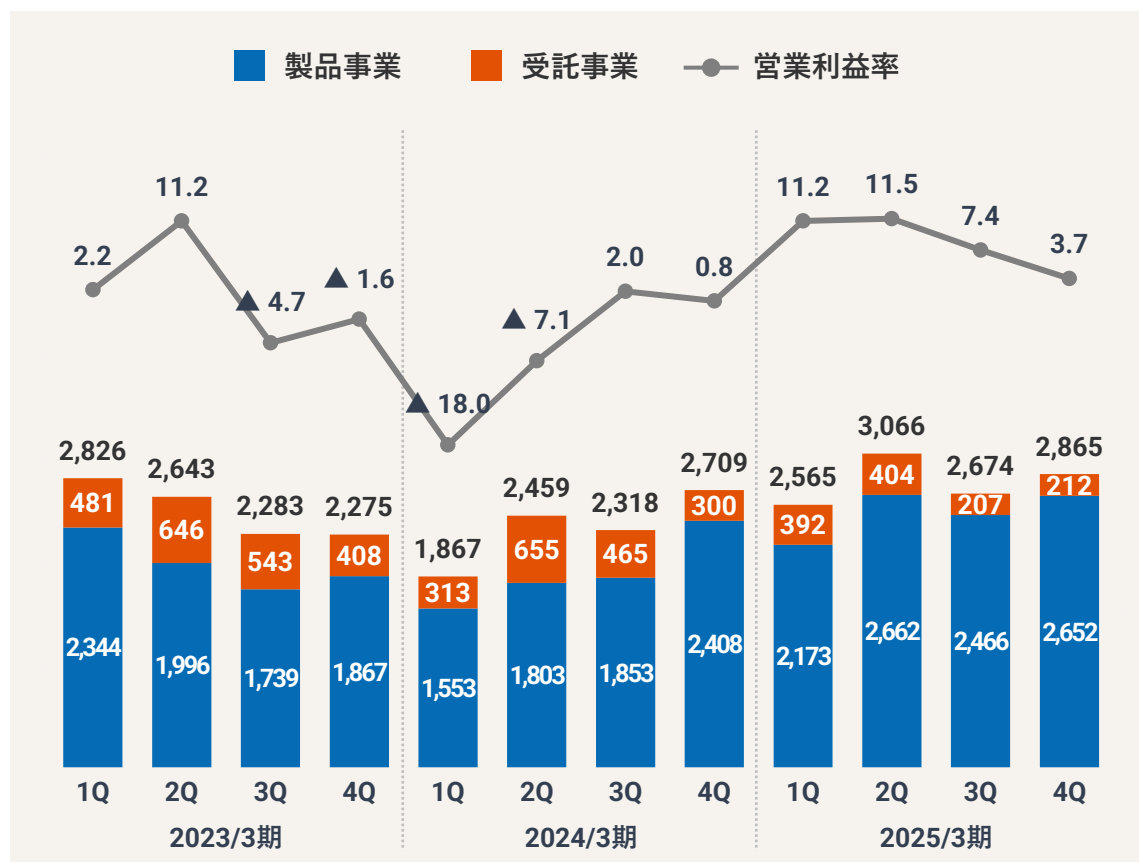
※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

02 四半期業績推移（連結）

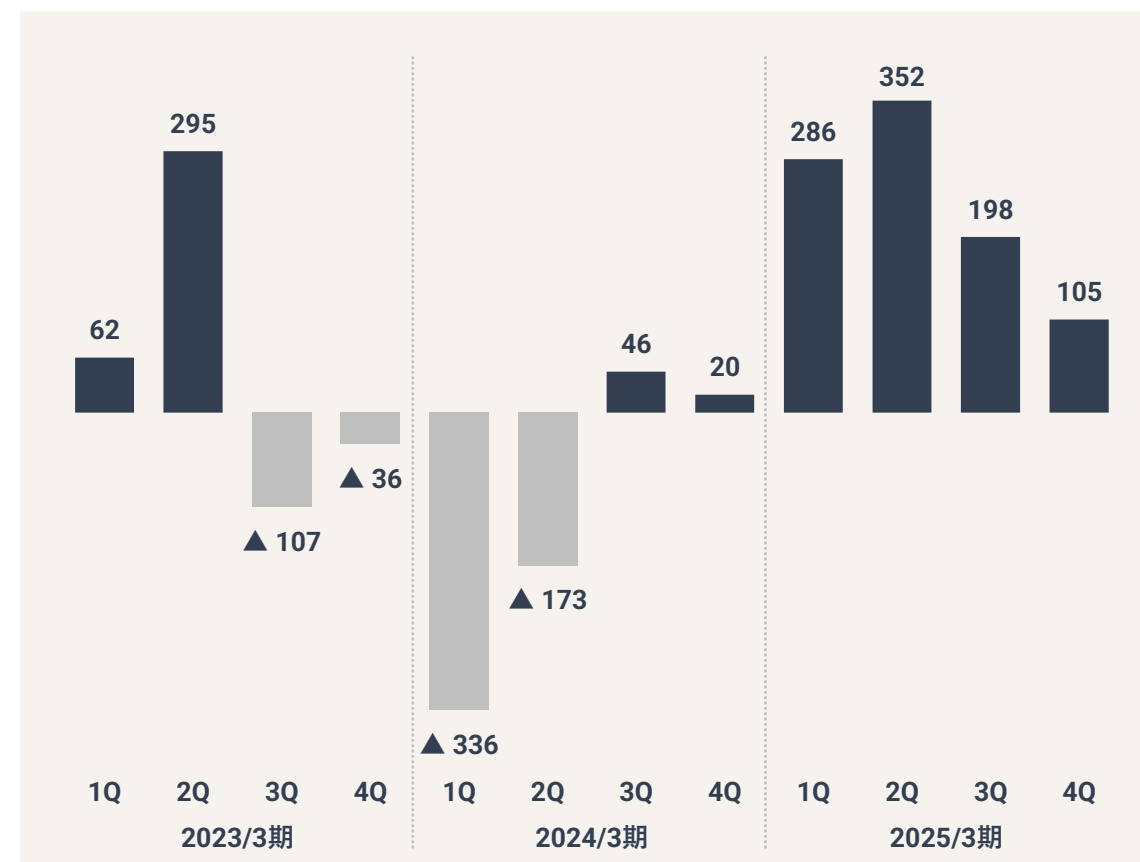
Mipox株式会社 2025年3月期 通期決算説明資料（証券コード5381）

ハイテク関連製品を中心に製品事業の売上は堅調に推移した一方、受託事業の売上は減少傾向にあり下半期ではさらに縮小しました。受託事業の利益減少に加え販管費の増加もあり、営業利益は下半期にかけて減少いたしました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



営業利益（単位：百万円）



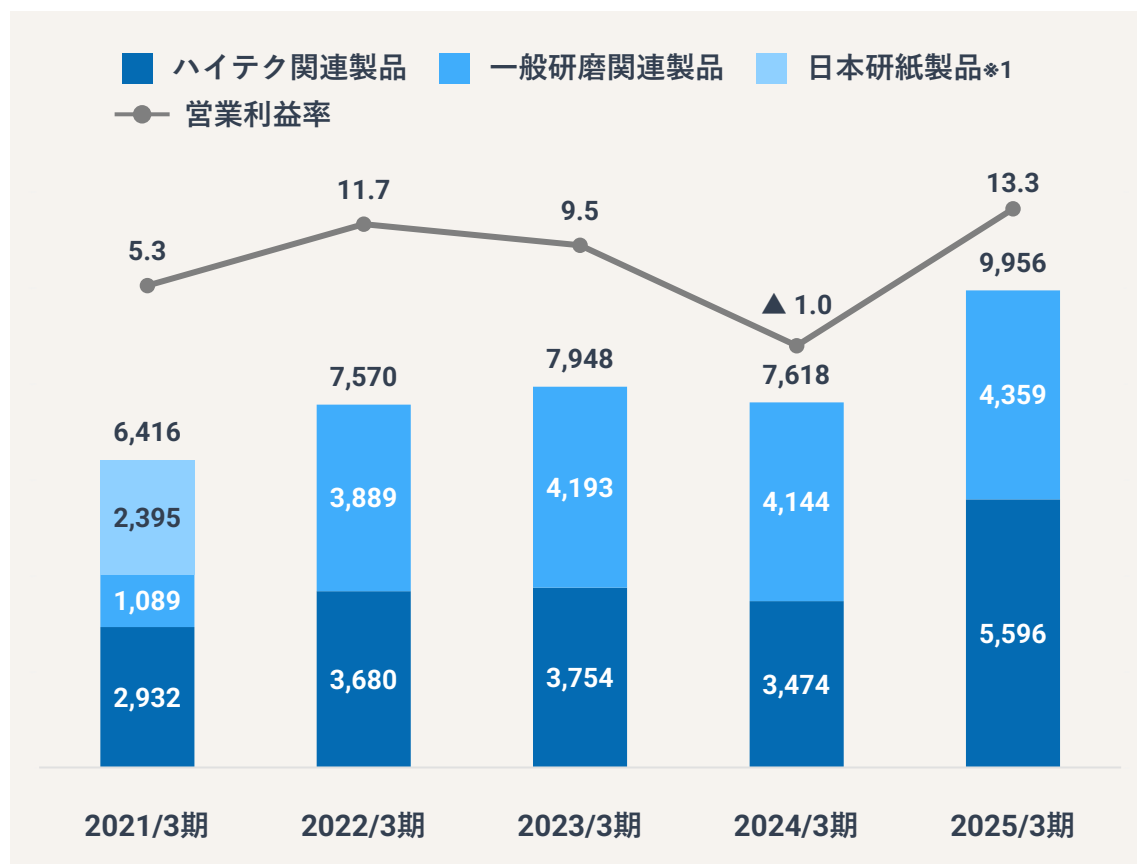
※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

02 通期業績推移（製品事業）

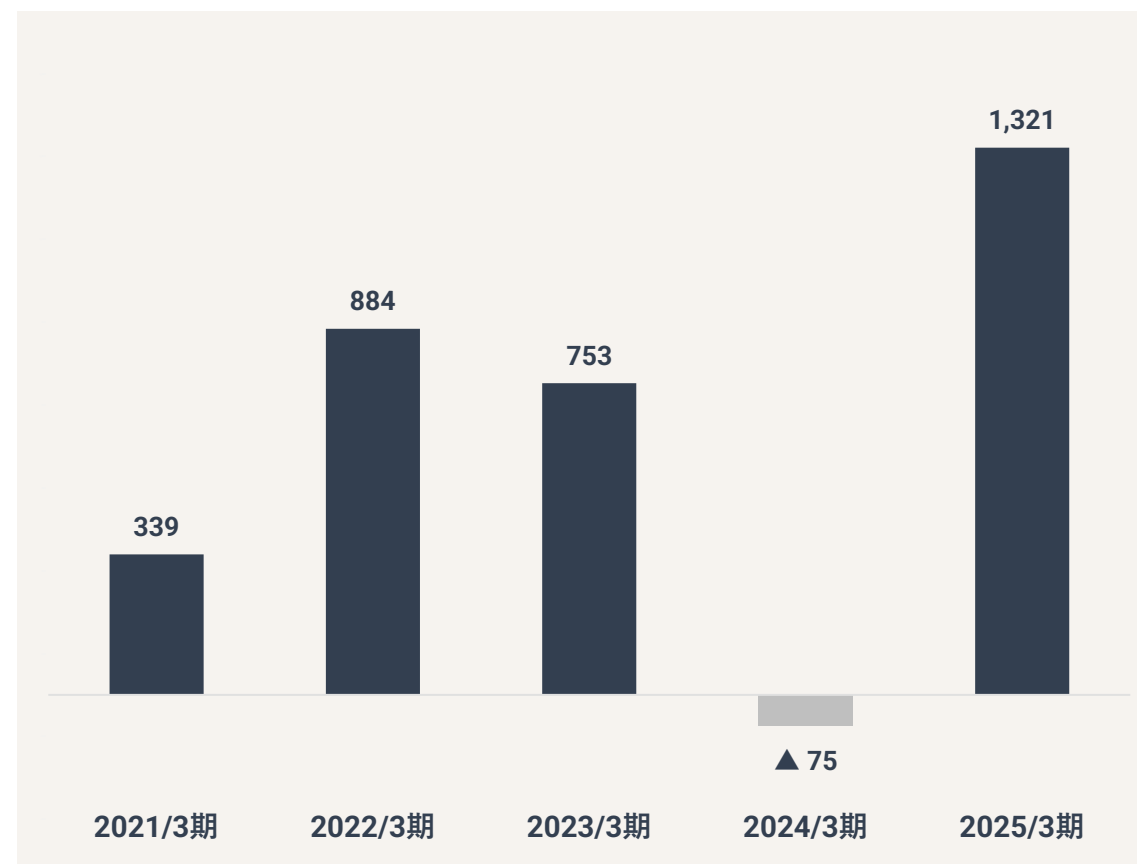
Mipox株式会社 2025年3月期 通期決算説明資料（証券コード5381）

ハイテク関連製品の売上が前期より大幅に増加し、一般研磨関連製品の売上も安定的に推移いたしました。利益面においても、相対的に利益率の高いハイテク関連製品が牽引し大幅な増収増益となりました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



営業利益（単位：百万円）

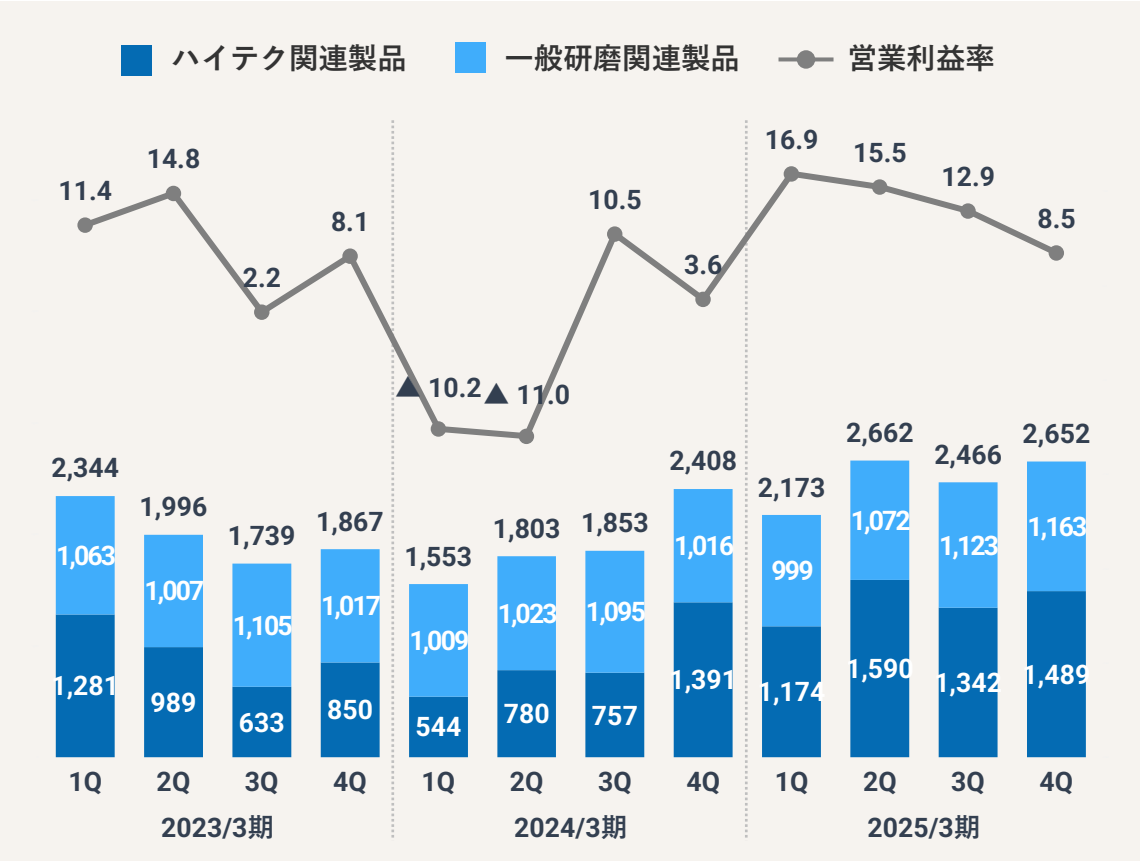


※1：日本研紙製品は一般研磨分野ですが、当時は子会社だったため一般研磨関連製品には含めておりません。2021年4月よりMipoxへ統合しております。

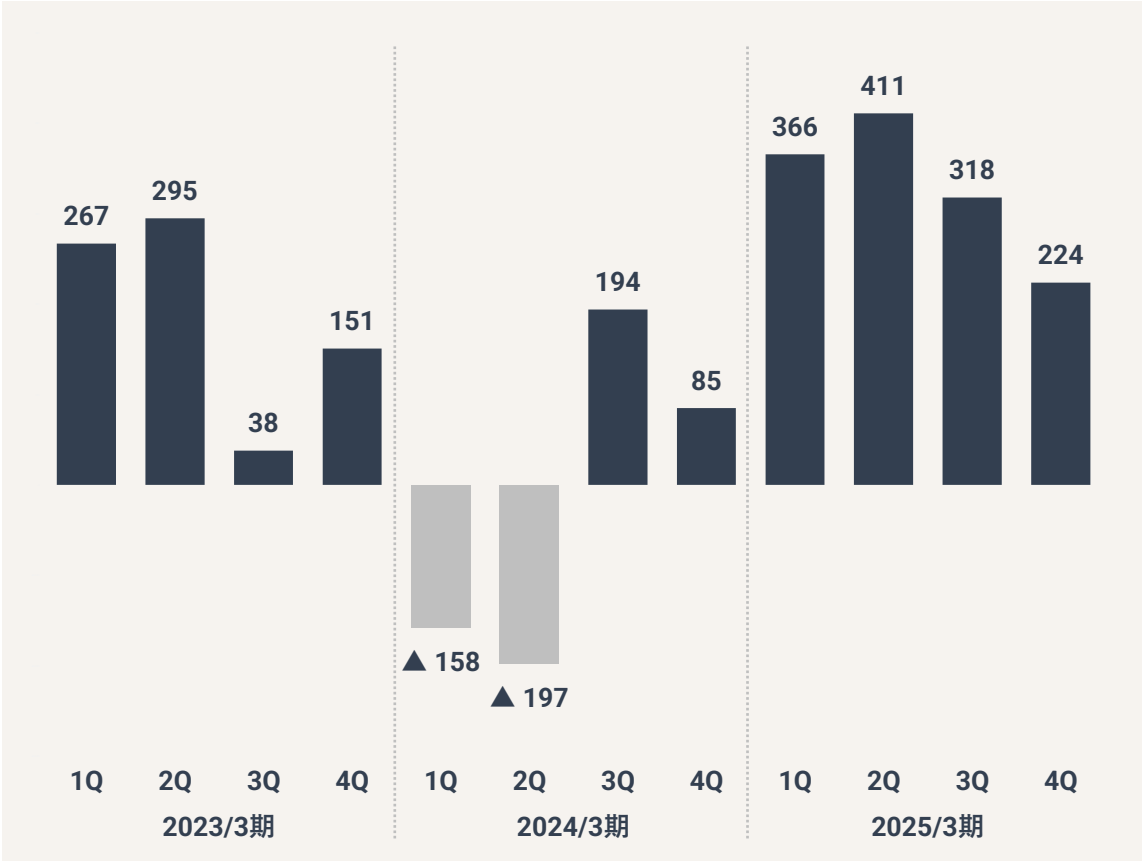
※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

四半期別においてもハイテク関連製品および一般研磨関連製品の売上は堅調に推移いたしました。一方で利益面は受託事業が落ち込んだことによる共通固定費の負担率が増加したことに加え販管費の増加もあり、セグメント利益は下半期にかけて減少いたしました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



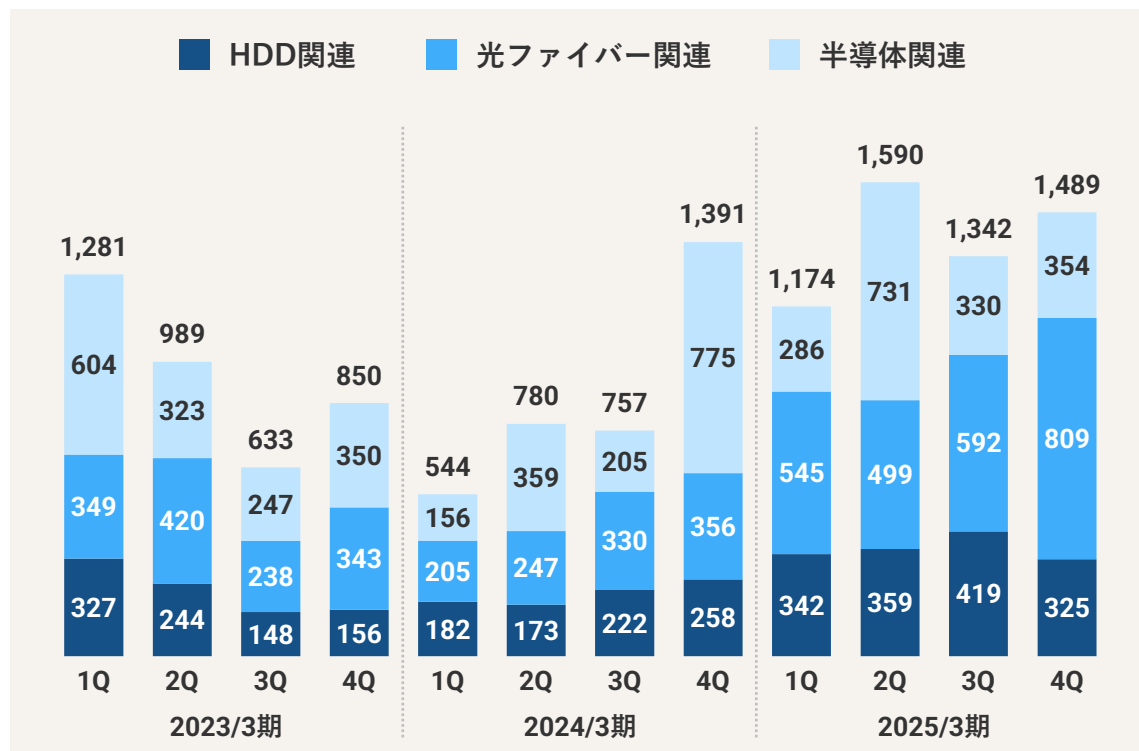
営業利益（単位：百万円）



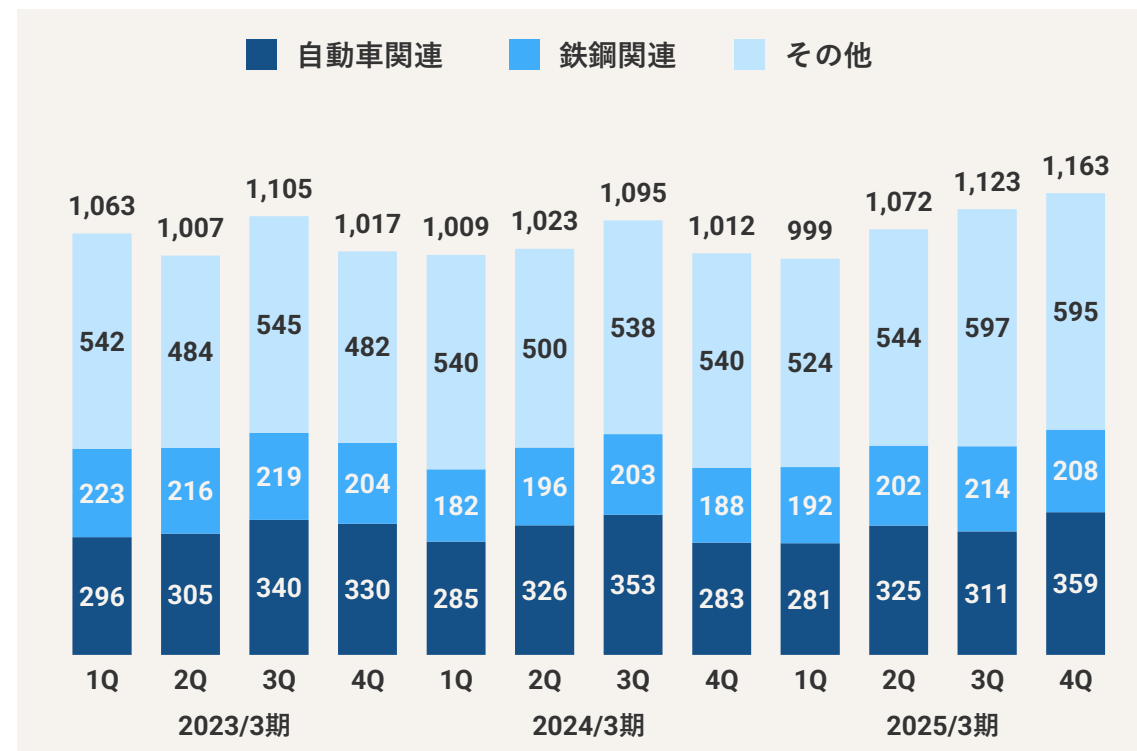
※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

ハイテク（HDD、光ファイバー、半導体）関連製品は、米国における光ネットワークインフラの整備や生成AIを支えるデータネットワーク設備の拡充を背景に、全用途において高水準の売上进行しています。半導体分野では、高価格帯のウェーハ研磨装置の売上がなかったものの、プローブカード、クリーニングシートを中心とした消耗材の販売が堅調に推移しました。HDDについては第4四半期に一時的な減少が見られたものの、需要は引き続き堅調で、事業の成長基調に変化はありません。一般研磨関連製品も各用途で安定した売上进行しています。

ハイテク関連製品（単位：百万円）



一般研磨関連製品（単位：百万円）

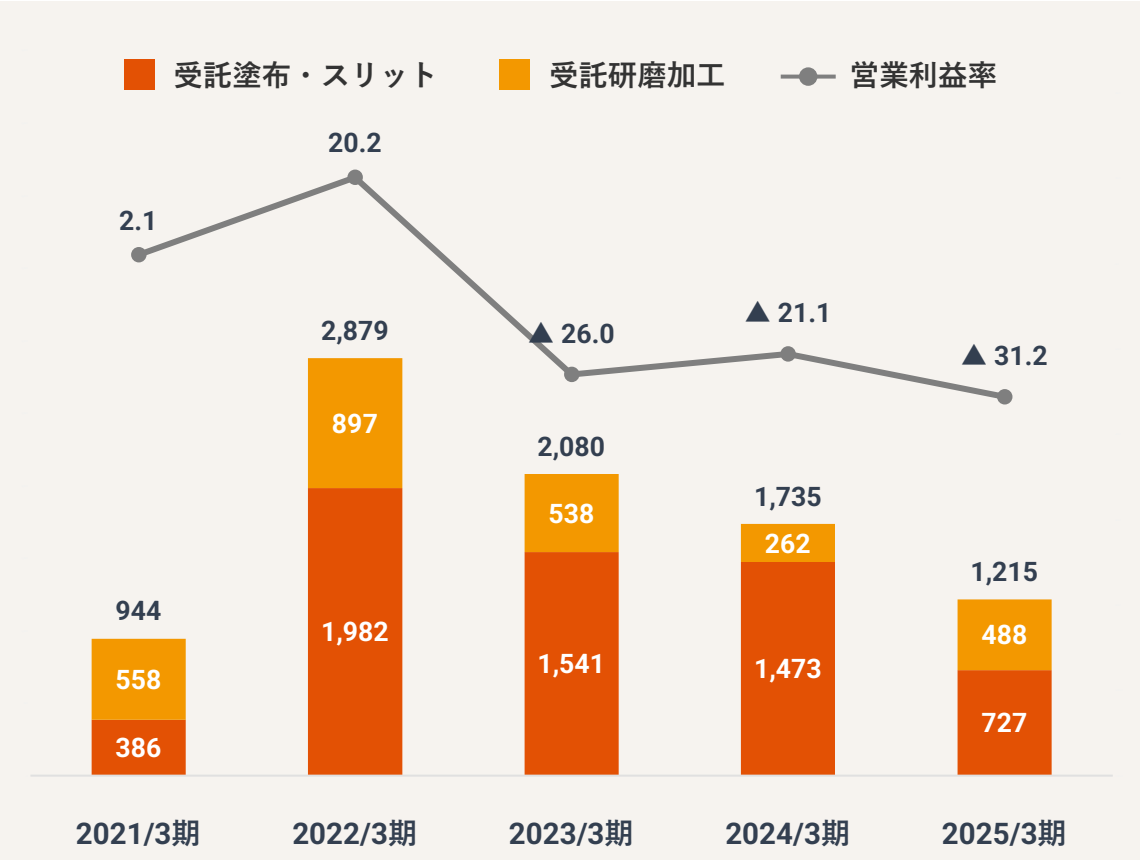


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

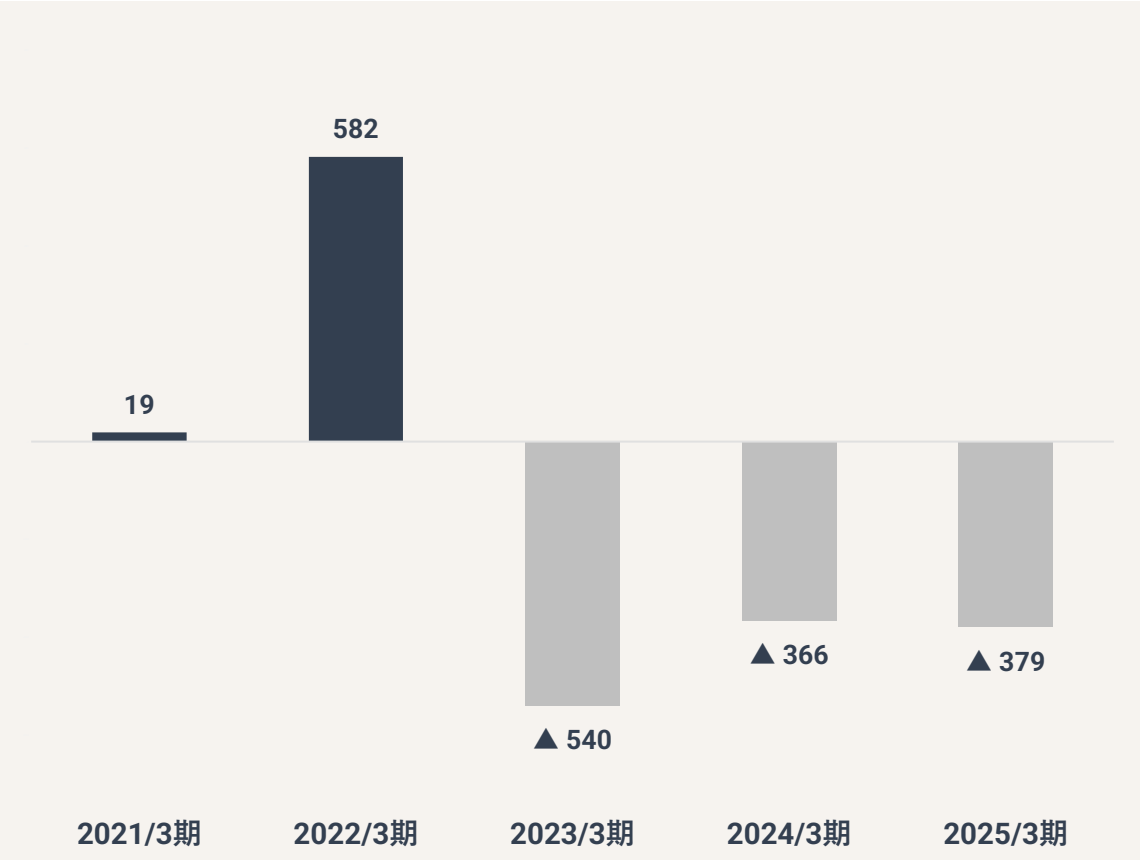
02 通期業績推移（受託事業）

次世代半導体関連の受託研磨に加え、2023年10月より参入した一般研磨関連の受託案件の堅調な売上もあり受託研磨加工の売上は大きく増加いたしました。一方で、PCやタブレット、スマートフォンなどエレクトロニクス製品向けのサービスが中心である受託塗布・スリット事業は、関連製品の需要動向や最終製品の仕様変更等の影響を受け、試作案件中心だったこともあり売上高が大幅に減少し、受託事業は減収減益となりました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



営業利益（単位：百万円）



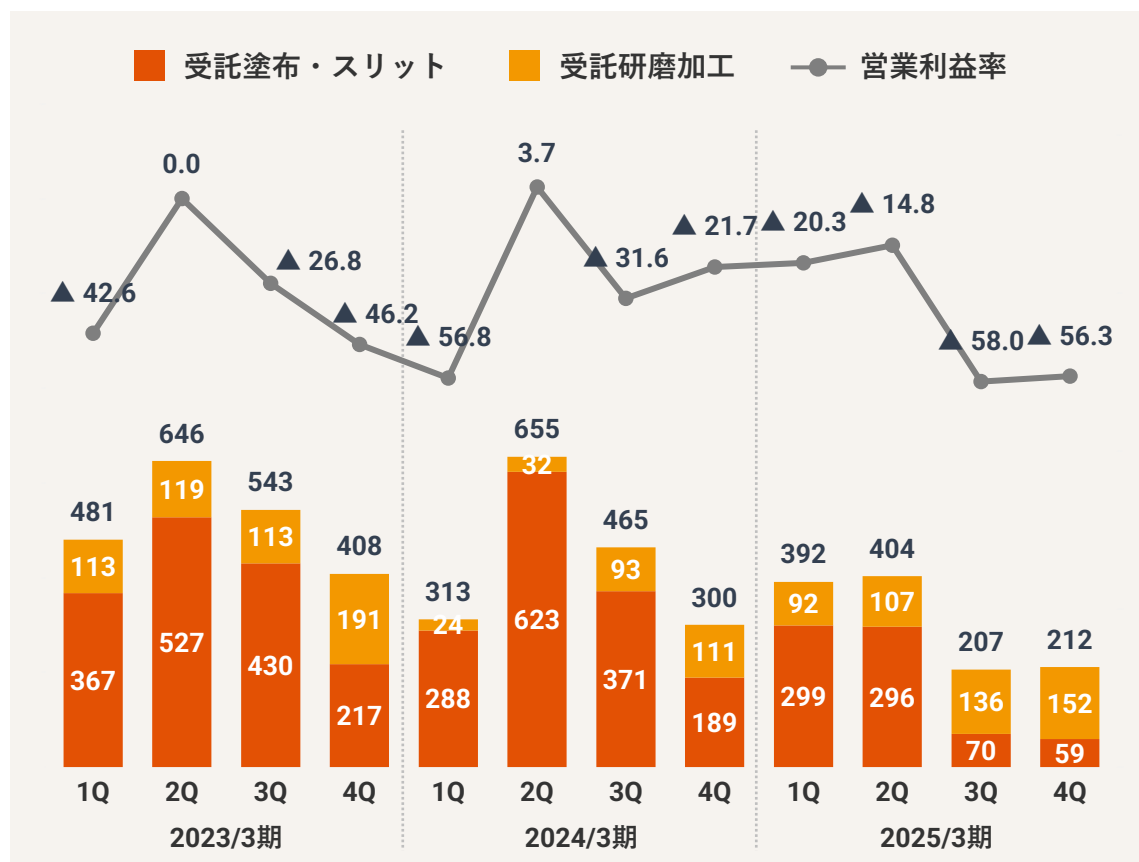
※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

02 四半期業績推移（受託事業）

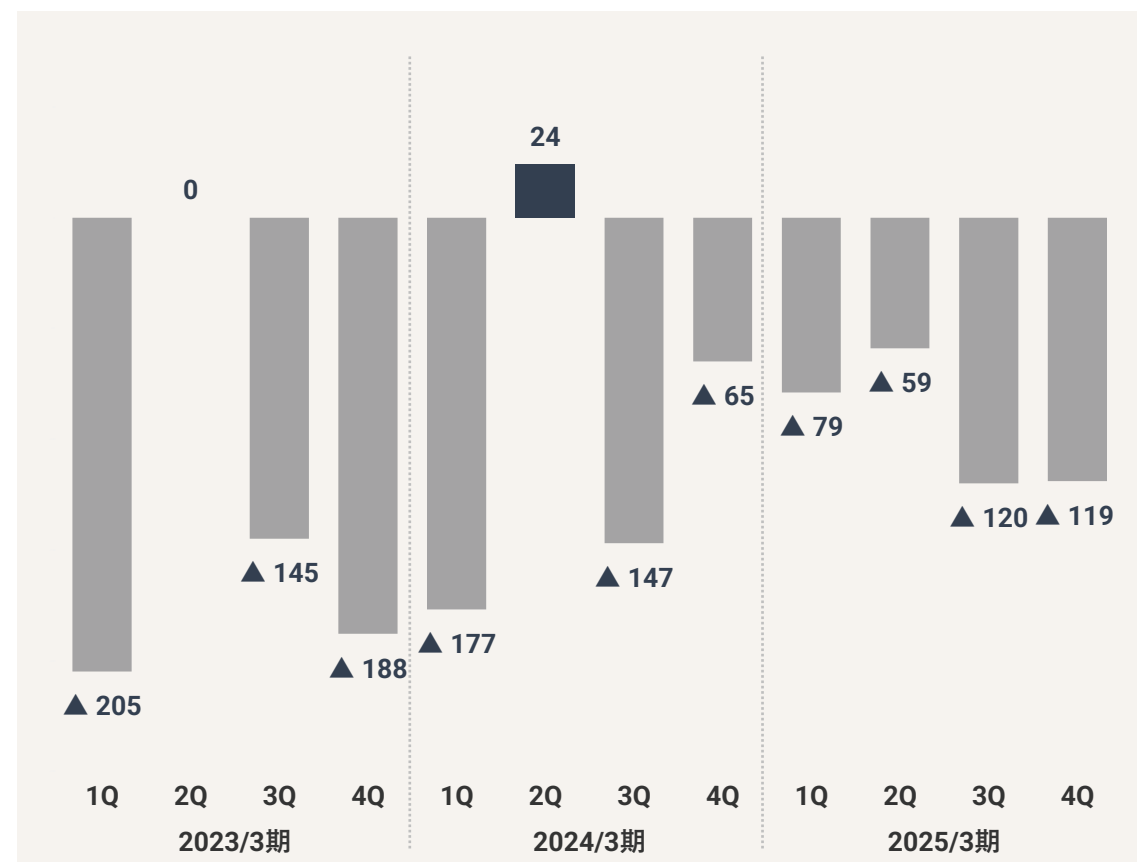
Mipox株式会社 2025年3月期 通期決算説明資料（証券コード5381）

四半期別では受託研磨加工の売上高が先端材料の研磨加工を中心に下半期にかけて増加した一方で、受託塗布・スリットの売上高は上半期をピークに下半期は試作案件が中心となり大幅に減少しました。それに付随して利益面においても下半期にかけて減少しました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・％）



営業利益（単位：百万円）



※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

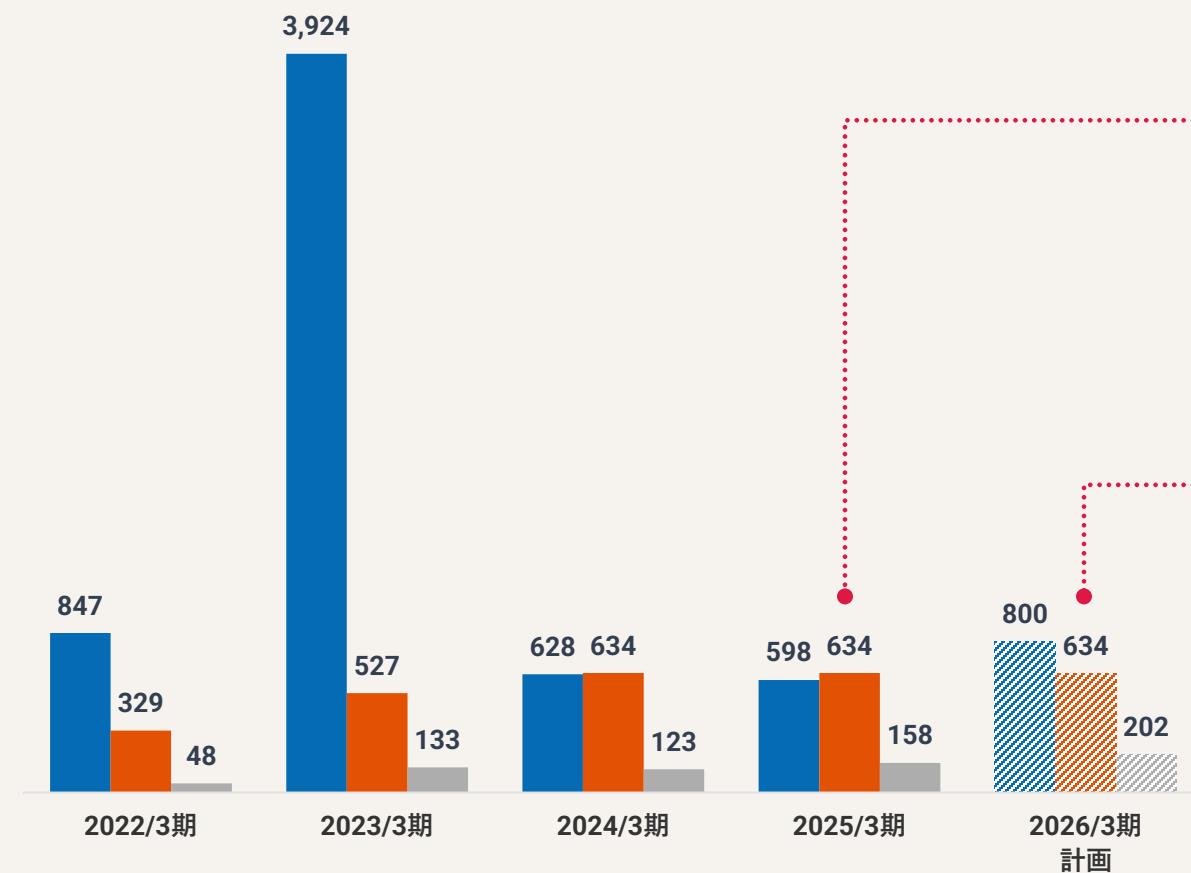
（単位：百万円）	2024/3期末	2025/3期末	増減額	備考
流動資産合計	8,773	8,465	▲307	
現金及び預金	2,692	2,407	▲284	
売上債権*	3,063	2,693	▲369	
棚卸資産	2,670	2,924	+253	
その他	347	439	+92	
固定資産合計	7,203	7,465	+261	
有形固定資産	6,596	6,737	+140	東京オフィスの内装・什器等を含む有形固定資産の増加
資産合計	15,977	15,931	▲46	
流動負債合計	4,930	5,438	+508	
支払手形及び買掛金	679	945	+265	
短期借入金（社債含む）	3,032	3,363	+331	短期借入金の増加
その他	165	133	▲32	
固定負債合計	3,563	2,028	▲1,534	
長期借入金（社債含む）	3,141	1,857	▲1,284	借入金の約定弁済
負債合計	8,493	7,467	▲1,025	
純資産合計	7,484	8,463	+979	純利益の増加
負債純資産合計	15,977	15,931	▲46	

*売上債権は受取手形、売掛金、電子記録債権を合計し、棚卸資産は商品および製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を合計しております。

*増減算出後、百万円未満切捨て

（単位：百万円）

■ 設備投資額 ■ 減価償却費 ■ 研究開発費



2025/3期の主な要因

- 【設備投資額】
 - ・ IH粉体塗装システム関連
 - ・ 東京オフィスの内装・什器等
- 【研究開発費】
 - ・ 次世代半導体プロジェクト関連の開発
 - ・ ハイテク関連製品の新製品開発

2026/3期の主な予定

- 【設備投資額】
 - ・ 受託研磨関連CMP装置等の取得
 - ・ 次世代半導体関連装置の取得
- 【研究開発費】
 - ・ 受託研磨関連の技術開発
 - ・ ハイテク関連製品の新製品開発

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2025年3月31日	4Q	北関東営業所に関するお知らせ（※）	P23 別途資料
2025年3月24日	4Q	株式会社みずほ銀行との「Mizuhoポジティブ・インパクトファイナンスPRO」の契約締結について	P24 別途資料
2025年2月3日	4Q	Ref Liteの反射材が「パリコレクション」発表の最新コレクションに採用	別途資料
2024年10月31日	3Q	Ref Liteのウルトラライトリフレクター「Midorikawa」 FALL WINTER2024新作の全身反射材ダウンジャケットに採用	別途資料
2024年10月1日	3Q	thomas 株式会社への出資に関するお知らせ	別途資料
2024年9月26日	2Q	ハンガー塗装剥離レーザー設備が「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」に採択	別途資料
2024年9月24日	2Q	金沢オフィスに関するお知らせ	別途資料
2024年8月27日	2Q	仙台オフィスに関するお知らせ	別途資料

※「北関東営業所」は現在「鹿沼オフィス」として運営しております。

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2024年7月10日	2Q	東京オフィスの移転(※)	別途資料
2024年7月4日	2Q	「グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築／次世代パワー半導体に用いるウェーハ技術開発／超高品質・8インチ・低コスト SiCウェーハ開発」成果報告書および事業戦略ビジョン公開のお知らせ	別途資料
2024年6月5日	1Q	中国拠点 深センオフィス移転のお知らせ	別途資料
2024年5月30日	1Q	IH 粉体塗装システムが「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」に採択	別途資料
2024年5月21日	1Q	新拠点「熊本サテライト」に関するお知らせ(※)	別途資料
2024年5月15日	1Q	新製品「SiC（炭化ケイ素）8インチ半導体ウェーハ専用研磨装置」の提供開始に関するお知らせ	別途資料
2024年4月26日	1Q	レーシングドライバー根本悠生選手とスポンサー契約締結のお知らせ	別途資料

※「東京オフィス」は現在「丸の内オフィス」、「熊本サテライト」は現在「熊本オフィス」として運営しております。

新たな営業拠点として

熊本・仙台・金沢・鹿沼にオフィス開設

製品事業における一般研磨分野のエリア戦略の一環として、熊本・仙台・金沢・鹿沼の4拠点に新たな営業拠点を開設いたしました。これにより、地域密着型の営業体制を強化し、各地域の主要産業への対応力を高めるとともに、顧客接点の拡充とサービスレベルの向上を図ってまいります。

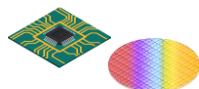
熊本オフィス

自動車産業や半導体産業等が栄える南九州エリアをカバー



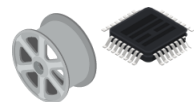
仙台オフィス

電子部品や鉄工業等が栄える東北エリアをカバー



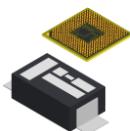
鹿沼オフィス

自動車・鉄鋼・半導体・電子機器など、多様な産業が盛んな北関東エリアをカバー



金沢オフィス

精密機械や電子部品の製造業者が多い北陸エリアをカバー



拠点名 熊本オフィス

2024年5月21日リリース

所在地 〒860-0803
熊本県熊本市中央区新市街1-28 THE・PLACE花畑ビル6F・7F

開設日 2024年6月1日



拠点名 仙台オフィス

2024年8月27日リリース

所在地 〒980-8485
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン 19階

開設日 2024年9月1日



拠点名 金沢オフィス

2024年9月24日リリース

所在地 〒920-0031
石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル8F

開設日 2024年10月1日



拠点名 鹿沼オフィス

2025年3月31日リリース

所在地 〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町18（本社/鹿沼事業所内）

開設日 2025年4月1日

ポジティブ・インパクト・ファイナンスの
融資契約を締結

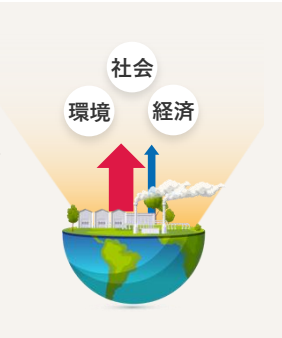
株式会社みずほ銀行と「Mizuho ポジティブ・インパクトファイナンスPRO」の融資契約を締結いたしました。
サステナビリティの取り組みを一層強化し、社会の持続可能な発展と豊かさの実現を目指していきます。

2025年3月24日リリース

組成総額	45億円
資金使途	運転資金
契約日	2025年3月24日
契約期間	2年

ポジティブ・インパクト・ファイナンスとは

企業活動が環境・社会・経済に与える影響(インパクト)を金融機関が包括的に分析・評価(インパクト評価)を行い、特定されたポジティブなインパクトの向上と、ネガティブなインパクトの低減に向けた取り組みを支援する融資



特定されたインパクト		KPI		SDGs	
大気	ポジティブ	IH粉体塗装システム販売数 ※単体かつ単年度の目標	2026年3月期：4社 2027年3月期：5社	2028年3月期：6社 2029年3月期：7社	
気候の安定性	ネガティブ	太陽光発電の創エネルギー ※単体かつ単年度の目標	2026年3月期以降、毎期1.3百万kWhを維持		 
気候の安定性 廃棄物	ネガティブ	ISO14001取得 ※単体かつ単年度の目標	2026年3月末までに福山事業所でISO14001認証取得 各事業所におけるISO14001認証を維持		 
雇用 その他の社会的弱者	ポジティブ ネガティブ	障がい者雇用率 ※単体かつ各時期までの目標	2026年3月末までに2.6％以上 2028年3月末までに2.8％以上		 
健康および安全性	ネガティブ	労働災害事故件数 ※単体かつ単年度の目標	0件を維持		 
健康および安全性	ネガティブ	有給休暇取得率 ※単体かつ単年度の目標	80％以上を維持		 



レーシングドライバー 根本悠生選手と スポンサー契約を締結

日本人初の欧州メーカー・ファクトリードライバーを目指す根本選手とスポンサー契約を締結。今後も事業を通して、モータースポーツと自動車産業全体の発展に寄与することを目指す。

2024年4月26日リリース



新製品「SiC（炭化ケイ素）8インチ半導体 ウェーハ専用研磨装置」の提供開始

精密研磨分野で培ってきた強みを活かし、SiC8インチ半導体ウェーハのノッチ/外周に特化した専用仕様の研磨装置を開発し、Mipoxの研磨フィルムを使用することで安定した面取り加工を施せる工法を確立。

2024年5月15日リリース



NEDOグリーンイノベーション基金事業の 成果報告及び事業戦略ビジョンの公開

「グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築／次世代パワー半導体に用いるウェーハ技術開発／超高品質・8インチ・低コスト SiC ウェーハ開発」成果報告書および事業戦略ビジョンの公開。

2024年7月4日リリース



丸の内オフィス拡大移転のお知らせ

原則出社体制への切り替えに伴うオフィススペースの拡張に対応するため、2024年7月29日より、丸の内オフィスをシェアオフィスから専用オフィスへ移転。

2024年7月10日リリース



thomas株式会社への出資

thomas(株)との資本業務提携契約を締結することを決議。本提携により、当社が進めるデジタルトランスフォーメーション（DX）推進における取り組みを一層強化。

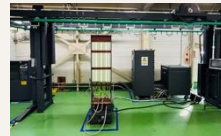
2024年10月1日リリース



「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援 事業費補助金」にIH粉体塗装システムが採択

IH（高周波誘導加熱）粉体塗装システムが令和5年度補正予算「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（通称：省エネ補助金）」「工場・事業場型」における『先進設備・システム』に採択。

2024年5月30日リリース



ハンガー塗装剥離レーザー設備が「省エネルギー 投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」に採択

当社のハンガー塗装剥離レーザー設備が、令和5年度補正予算「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」において、省エネ補助金対象の先進設備・システムとして採択。

2024年9月26日リリース



再帰性反射材「Ref Lite（レフライト）」が ファッションブランドに採用

再帰性反射材「Ref Lite」がファッションブランド「Midorikawa」「White Mountaineering」に採用。また、「White Mountaineering」の2025SSコレクションの一部として、当素材が「パリコレクション2024」で発表。

2024年10月31日リリース

2025年2月3日リリース



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期
通期実績

FY2025 Full Year Financial Results

03

2026年3月期
業績見通し

FY2026 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
2026年3月期予想 (A)	11,000	900	1,000	700
2025年3月期実績 (B)	11,172	942	855	911
増減額 (B-A)	▲172	▲42	145	▲211
増減率	▲1.5%	▲4.5%	+16.9%	▲23.2%

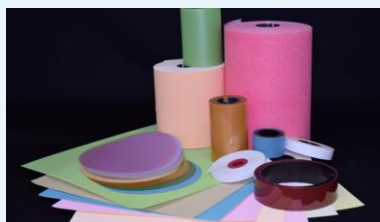
*増減算出後、百万未満切捨て

【コメント】

- ・ 2026年3月期は製品事業ではハイテク関連製品の売上高が引き続き堅調に推移する見通しですが、米国の通商政策など先行き不透明な要素があり慎重な見極めが必要であると認識しております。受託事業では受託研磨加工分野でCMP案件を中心に販売増を見込んでいる一方、受託塗布・スリットは量産案件の獲得が厳しく引き続き先々に向けた試作案件が中心となる見通しです。以上により、2026年3月期の売上高は対前年比で1.5%減少の110億円を見込んでおります
- ・ 引き続きECを活用した販売チャネルの多様化や製造DXでの工場の自動化・省力化等を通じ、コストの構造的な改善を進めてまいります。また、将来に向けた人材育成をはじめとする人的資本への投資を強化してまいります。結果、2026年3月期の営業利益は9億円を想定しています。前期に引き続き受取賃借料の計上を見込んでおり経常利益は10億円、親会社株主に帰属する当期純利益は7億円を予想しております。

米中関係や米国による関税措置など、依然として不透明な外部環境要因が残存していることから、市況全体の本格的な回復には慎重な見極めが必要であると認識しております。今後もこれらの動向を注視しつつ、リスク管理の徹底を継続してまいります。

ハイテク関連製品



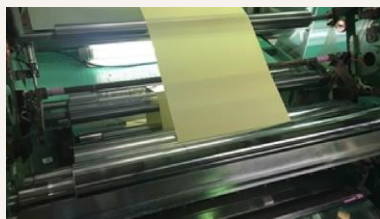
- 米国の光ネットワークインフラ整備や生成AI関連のデータネットワーク設備強化の動きから、光ファイバー関連製品が好調な状況が継続する見通しです。高まる需要に対し生産、及び供給体制の改善に対応してまいります。
- HDDの在庫調整が一巡し、汎用データセンター向けの投資も回復傾向にあります。今後もこの市場環境が継続する見込みであり、引き続き安定した成長が期待されます。
- 半導体関連製品では工場稼働率は依然低水準ながら、生成AI向け半導体需要の拡大によりプローブカードクリーニング製品の販売は増加傾向にあり、売上は前期並みを維持する見通しです。

一般研磨製品



- 建設業界をはじめとする各産業は、物価や景気動向に対応した政策の影響を受けながら、市場全体の動きが形作られていくと見えています。自動車業界については、在庫調整を進めつつ状況を注視し、上半期中には一定の方向性が見えてくる見通しです。
- 原材料およびエネルギーコストについては、依然として高水準での推移が見込まれており、厳しい環境が続くと予想されます。当社としては、引き続き顧客価値を最優先としながらも必要に応じて価格転嫁を含む柔軟な対応を検討してまいります。
- IH粉体塗装技術を活用した研磨製品の試作ラインの立ち上げが完了しました。今後は、北杜事業所と福山事業所との連携を一層強化し、データベースの構築に向けて整備を進めてまいります。今期は製造のプロセスの確立を目指して取り組んでまいります。
- 営業拠点については、地域ニーズや事業展開に応じて、必要に応じた開設を柔軟に検討してまいります。当社では、これまでのIT投資により営業活動に必要な情報がデータベース化されており、営業担当者がスムーズかつ的確に対応できる体制を整えていることが強みです。こうしたデジタル基盤を活用し、ECサイトの拡充も目指してまいります。

受託塗布・スリット



- ・ 量産の獲得は依然として難しい状況が続いていますが、試作の受注は増加傾向にあり、特に中・大型案件や半導体関連の試作が増えています。また、半導体関連の試作の取り扱いも増加しており、今後の成長に向けた足掛かりとなる可能性があります。
- ・ 新規顧客開拓も展示会出展などを通じて進展しており、試作案件や問い合わせは増加傾向にあります。一方で、案件ごとの進捗にばらつきがあり、量産開始は2027年3月期以降になる見通しです。当面は試作対応が中心となる予定です。
- ・ 試作案件が中心で推移していることから、一部の工程では工場ラインに余裕が生じております。この空きリソースを既存製品の製造に活用することで、稼働率の向上と収益の安定化に努めています。

受託研磨加工



- ・ 高付加価値CMP案件の受託拡大を見据え、前期比で販売増を見込んでおります。それに伴い、CMP案件の受け入れ体制を強化すべく、測定機、CMP装置、洗浄機等に対する計画的な設備投資を実施する予定です。
- ・ 2026年3月期において量産に直結するケースは限定的ではあるものの、一部の案件では継続的な加工および数量の増加が見込まれております。
- ・ 注力している先端材料の高難度加工技術の実績積上げにより、GaN基板、ダイヤモンド基板など次世代パワーデバイス用基板の研磨受託加工が引き続き堅調で増加が見込まれます。
- ・ 従来の研磨加工に加え、接合や洗浄など前後工程を含めた一括受託体制を整備し、製造プロセス全体をカバーするファウンドリーサービスの展開を推進しています。研磨に加えた接合加工やコアリング加工に対応するとともに、加工パートナーとの連携を通じて、一貫した受託体制を構築。前後工程を含めた包括的な加工受注に注力してまいります。

当社は将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様に対しては安定配当を目指しつつ、業績等を勘案して、適正な利益還元に努めております。

配 当

2024年11月14日に開示いたしました2025年3月期第2四半期決算時に復配の予定をお知らせしておりましたが、通期業績の確定を受け、期末配当金を1株当たり10円とし、復配することといたしました。

年 間 配 当	
2024年3月期	無 配
2025年3月期	10 円
2026年3月期	10 円（予想）

自 社 株 買 い

2025年5月15日開催の取締役会において、資本効率の向上、および株主還元の充実を図るため、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。

取得株式数	当社普通株式50万株(上限) ※発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.47%
取得総額	2億円(上限)
取得期間	2025年5月16日から2025年7月31日まで
取得方法	東京証券取引所における市場買付
ご 参 考	2025年3月31日時点の自己株式の保有 発行済株式総数（自己株式を除く）： 14,422,368株 自己株式数： 29,552株

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期
通期実績

FY2025 Full Year Financial Results

03

2026年3月期
業績見通し

FY2026 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

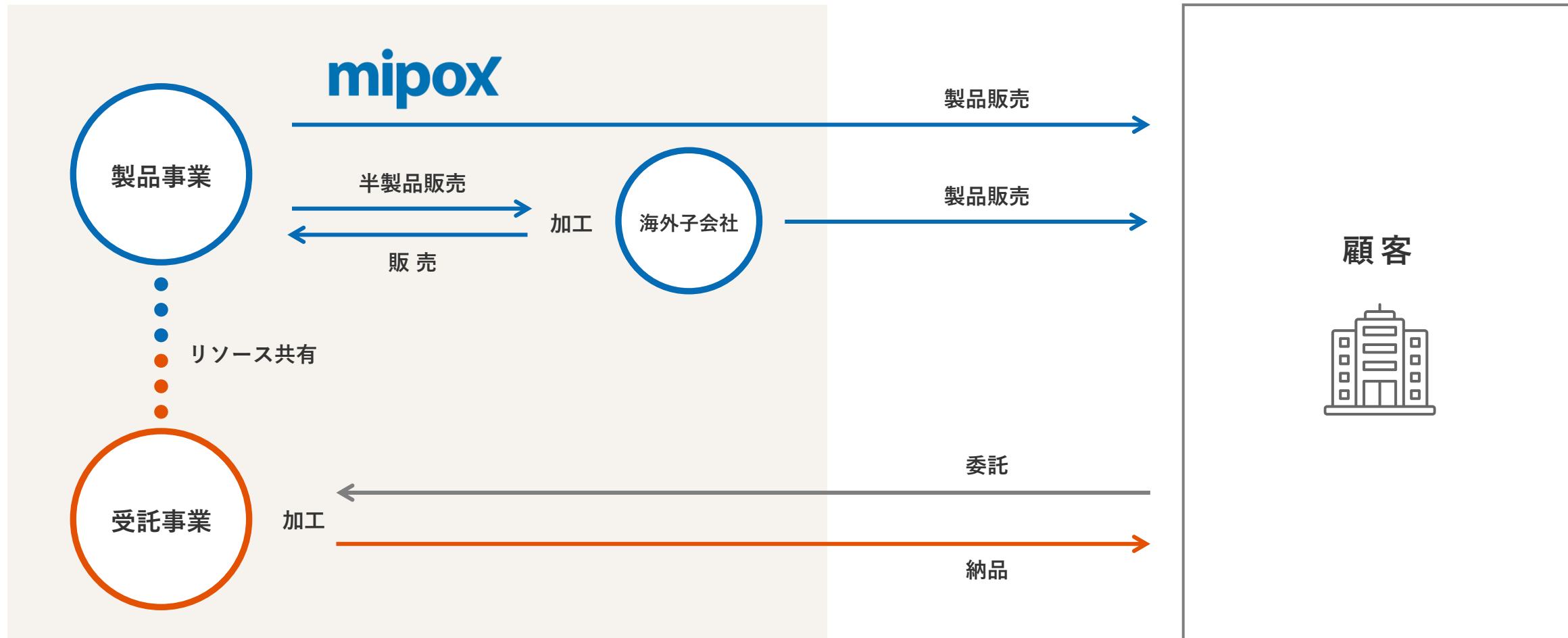
Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

海外工場での加工を経ることにより、日本のみに工場が存在するよりも様々な製品を効率よく製造しております。海外向けに販売も行っております。顧客からの委託を受けて加工も行っており、自社製品のみならず顧客の要望に合わせたサービス・製品も提供しております。



製品事業

研磨材の開発・製造・販売を行っております。
超精密研磨から一般研磨、装置や反射材など、世界中の幅広い用途に向けて当社製品を提供しております。



研磨フィルム



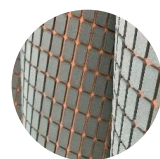
液体研磨剤



研磨関連製品



研磨布紙製品



研磨砥石製品



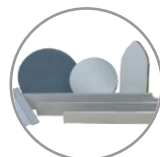
研磨周辺機器



検査装置



再帰性反射材
(Ref Lite)



ヤスリ製品



IH粉体塗装

受託事業

【受託研磨加工】

半導体ウェーハをはじめとする材料を顧客より預かり、当社が保有する設備（研磨装置、洗浄機、検査装置）と独自の研磨材を用いて、要望に沿った研磨加工を提供しております。

【受託コーティング・スリット】

顧客の基材（フィルム等）や塗料材を預かり、当社が保有する設備（調合、コーティング、スリット）を用いてフィルム化、裁断を行っております。



塗布製品



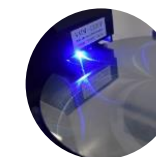
研磨加工



スリット加工



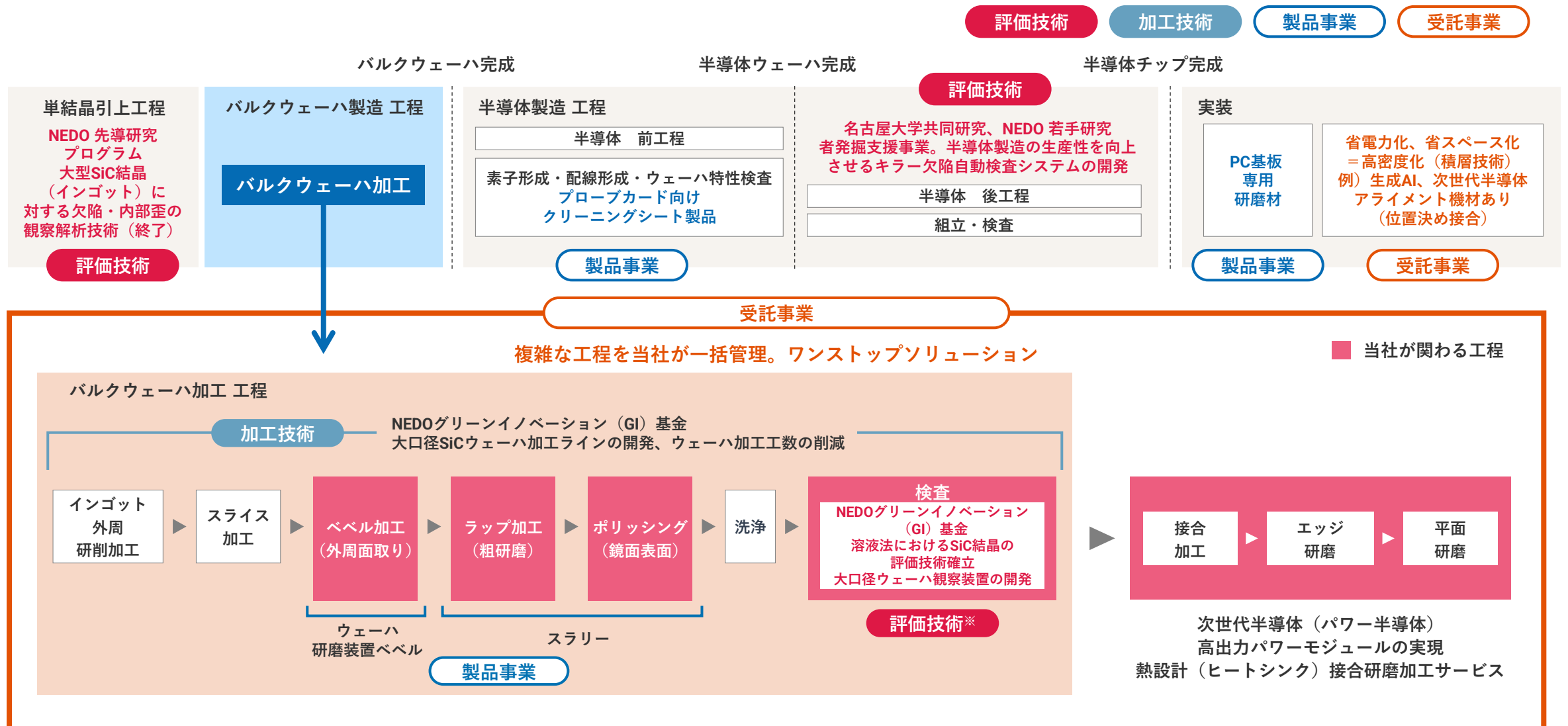
常温接合加工



検査

04 半導体サプライチェーンにおける当社の技術と事業区分

Mipox株式会社 2025年3月期 通期決算説明資料（証券コード5381）



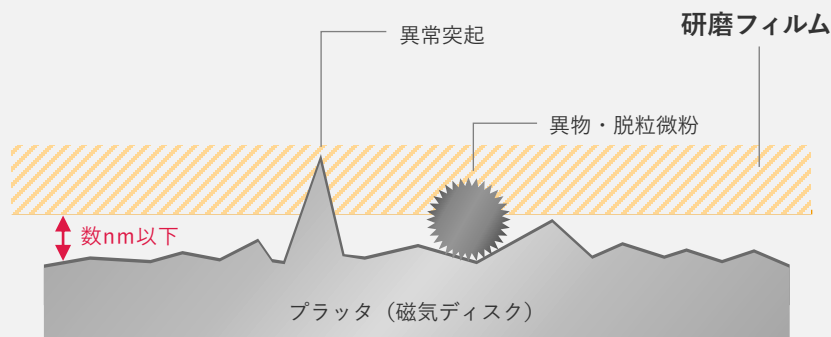
※NEDOグリーンイノベーション基金での支援事業は社会実装までは利益を上げることが出来ず、収益化は社会実装後になります

ハードディスクドライブ（HDD）内部のプラッタと呼ばれる磁気ディスクの表面研磨に当社製品を使用。ヘッド部に接触しないよう、1000分の1μ程度の突起や異物を除去します。各ハードディスクメーカーの仕様に応じたカスタマイズ製品を製造・供給しています。



ハードディスクドライブ（HDD）の研磨

当社の研磨フィルムは、独自のバインディング技術とスリット技術により、研磨フィルムから砥粒や異物がディスク上に残らないよう設計されています。この高度な技術は非常に高い難易度を誇り、他社が模倣することが難しい当社の競争力の源です。



Mipoxの強み

Strength

01 カスタマイズ可能

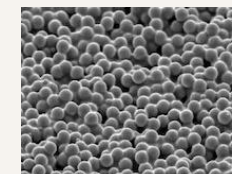
「塗る」技術の活用により、研磨層表面の形や大きさ、溝の深さ・粗さ等、各社に合わせた研磨フィルムを提案可能です。



Strength

02 球状で傷をつけない

「塗る」技術の活用により、フィルムに球状の研磨材を均一に塗布。表面突起がないため、ディスクに傷をつけずに異物の除去が可能です。



Strength

03 端面まで高精度

「切る」技術の活用により、研磨フィルムの高精度な端面を実現。研磨時の傷の軽減など、品質向上に寄与しています。

他社製品 当社製品



ガラス製のファイバー線と、それを保持するフェルール（酸化ジルコニウム製）を研磨することで、接触面を滑らかにし、光信号の損失を最小限に抑えることができます。これにより、通信の質が向上します。先端に付着した樹脂の除去から、鏡面化までを当社の製品で行います。

単芯タイプ 光ファイバーの研磨工程例

1本の光ファイバー線で構成。安価で長距離通信が可能。
一般消費者向けネット通信（テレコム）等々に使用される。



多芯タイプ 光ファイバーの研磨工程例

12～24本の光ファイバー線で構成。高価で付加価値が高い。
短距離通信限定＋大容量通信が可能でデータセンター等に使用される。



Mipoxの強み

Strength

01 環境負荷を低減

廃液を排出するスラリーに代わり植毛フィルムを使用することで、廃液問題の解消と環境負荷の低減を実現。環境基準が厳格な国々において、当社の製品は優位性を発揮します。

Strength

02 研磨材メーカーの製品力

研磨材メーカーとして、基材・砥粒・パインダーの多様な組み合わせにより、最適な製品を提供可能です。

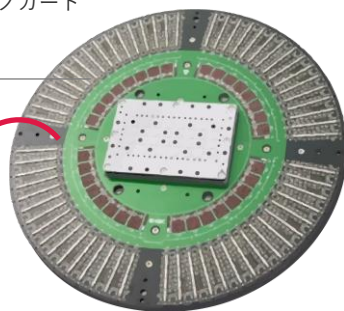
Strength

03 研磨ニーズへの対応力

精密業界で培った長年のノウハウを活かし、研磨条件の最適化を提案し、さまざまな要求に柔軟に対応します。

半導体製造工程の中の、主に前工程であるウェーハ検査工程で使用される検査用器具「プローブカード」のクリーニングシートを提供。多くの半導体関連メーカーへの提供実績があり、幅広い製品ラインナップで、あらゆるタイプの針先クリーニングに対応いたします。

プローブカード



ウェーハ検査用「プローブカード」の針先研磨

「プローブカード」とは、半導体のウェーハ検査工程で使用される検査用器具です。プローブ針からウェーハに電気を流し、正常に動作するか検査を行います。このプローブ針の汚れのクリーニング及び先端形状の保持に、当社のクリーニングシートが使用されております。

プローブカード

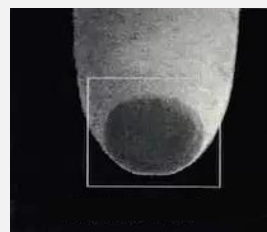
プローブ針

ウェーハ

針先クリーニング前



針先クリーニング後



Mipoxの強み

Strength

01 針を摩耗せず汚れを除去

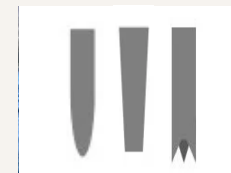
当社のクリーニングシートは針を摩耗せずに汚れの除去が可能です。高価なプローブカードの寿命を延ばすことに寄与します。



Strength

02 豊富な製品ラインナップ

プローブ針には丸・フラット・クラウン等、様々な形状があり、それぞれの形状に合わせたクリーニング製品を提供可能です。



Strength

03 様々なテスト環境に対応

低温から高温まで、様々なテスト環境に対応した製品を取り揃えております。



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期
通期実績

FY2025 Full Year Financial Results

03

2026年3月期
業績見通し

FY2026 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

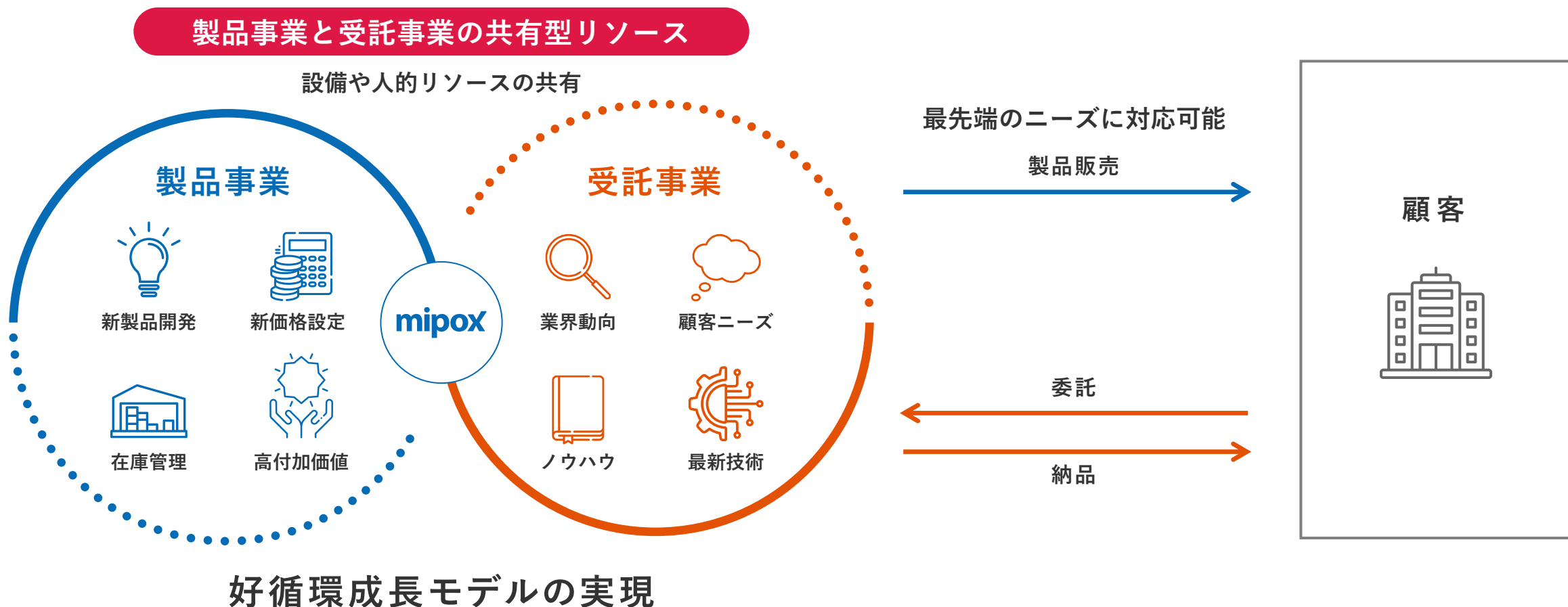
1 事業間で発揮されるシナジー効果

2 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

3 スマートファクトリー



製品事業と受託サービス事業では設備や人的リソースを共有しており、技術やノウハウの蓄積に役立っております。
蓄積された技術やノウハウは高付加価値のある製品やサービスの創出に活かされ、顧客の多様な要望を実現する源になっております。



製品製造と受託加工ができるため、顧客の理想に合わせた製品の作成、きめ細やかなサービスの提供が可能です。
各製造工程において異なる取引先との煩雑なやりとりを当社がワンストップで提供しており、顧客の要望が1つの窓口で完結いたします。

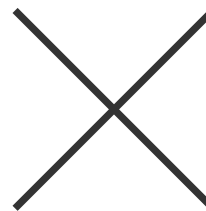
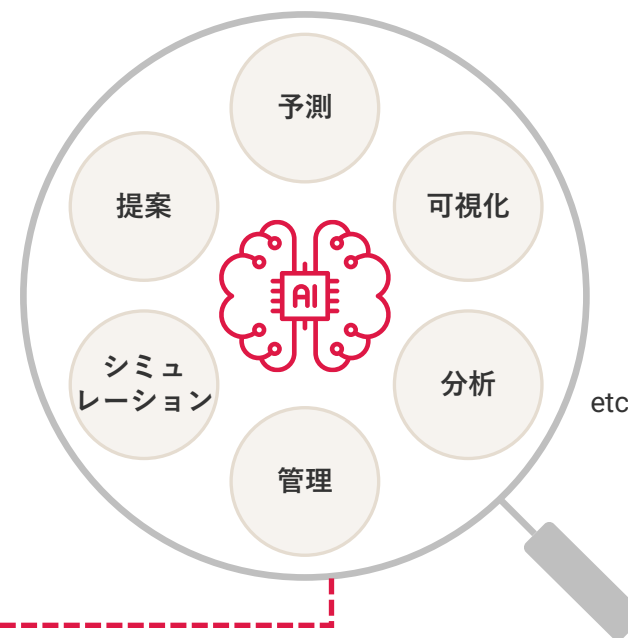


IoTとAIを活用し連携させることで、可視化しづらい部分の改善に役立つデータを収集しております。
工場のDX化により、さらなる効率化・高品質化を目指します。

IoT あらゆる機器を連携させ、
様々なデータを収集・蓄積



AI IoTで集めたデータを
分析して課題が見える化



業務プロセスの改革

品質・生産性の向上

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期
通期実績

FY2025 Full Year Financial Results

03

2026年3月期
業績見通し

FY2026 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

1 製品・受託事業領域の拡張

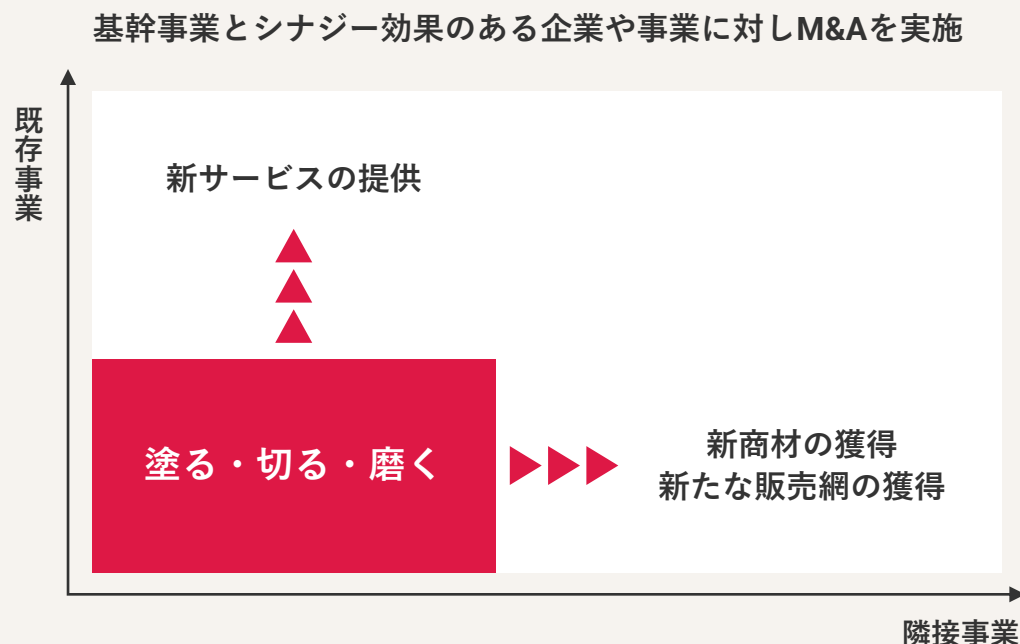
2 鹿沼事業所の量産体制構築

3 産官学プロジェクトへの参画



当社の基幹技術「塗る」「切る」「磨く」*の事業領域を拡大するための打ち手として、M&Aを実施してまいりました。
今後も製品・受託事業領域の拡張を行ってまいります。

【M&Aに対する基本的な考え方】



【これまでのM&A実績】

 反射材製品、 精密研磨フィルム等の 製造・販売 (2015年) 塗る	 研磨布紙及び その他研磨材製商品の 製造・販売 (2016年) 塗る 切る 磨く	 フレキシブル・ 超高品質なヤスリの 開発・製造 (2021年) 磨く
 研磨ディスクの 製造・販売 (2022年) 塗る 磨く	 スガ コーディングス 有機溶剤不使用の コーティング事業 (2023年) 塗る	 金属パーツの 精密研磨加工 (2023年) 磨く

多様化するニーズに、迅速且つ的確に対応できる体制の構築

当社のコア技術の一つである「塗る」に関連する技術であるIH粉体塗装技術を利用し事業展開を図っていきます。鹿沼事業所に開設した実証実験ラボの積極的な活用に加えて、IH粉体塗装技術を活用した自社製品の開発に向けて設備の導入を進めています。

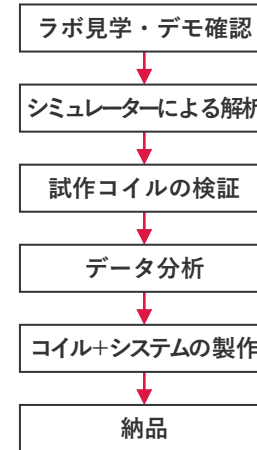
【実証実験ラボのIH粉体塗装システム】

特許取得済 (特許第7560971号)



実証実験ラボ見学の様子

2023年3月に譲り受けた株式会社スガ コーティングのIHを活用したコーティングラインの企画・設計・開発・販売を展開し、溶剤不使用のコーティング技術の導入支援を行っています。2023年10月に鹿沼事業所に開設した実証実験ラボを積極的に活用しながら、製造工程の中で最もエネルギーを要する設備であるガス熱風乾燥炉を、IHを利用した電気加熱方式であるIH粉体塗装システムに置き換えることによって省エネ、省スペースを実現できる塗装工程ラインをご提案しております。



ラボで事前検証が可能に

新技術に対する顧客の不安を払拭し、スムーズなシステム導入に寄与

IH粉体塗装技術の活用体制強化

技術・ノウハウを共有

福山事業所
自社製品の研究・開発

鹿沼事業所(本社)
実証実験ラボ
受託製品の研究・開発

北杜事業所
自社製品の研究・開発

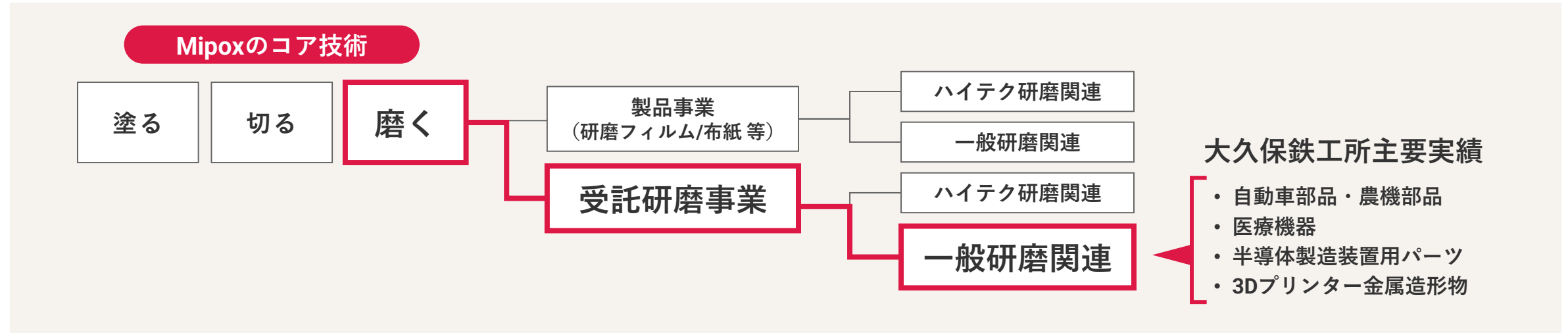
NEW

福山事業所に加え、北杜事業所でもIH粉体塗装システムの導入を進め、実証実験ラボや各事業所で得られた技術・ノウハウを活用して自社製品の開発を進めてまいります。



IH粉体塗装技術で製造した研磨製品

2023年10月31日に大久保鉄工所をM&Aにて取得、これにより当社の主要事業すべてにおいて一般研磨用途の参入が可能となり、さらなる対象市場の拡大と新規顧客の獲得が期待されます。



【当社とのシナジー】

mipox



OOKUBO IRON-WORK

- 01** 鹿沼事業所に近く、人材の融通＋スペース拡張（投資）が容易
- 02** 高い技術競争力と収益性
- 03** 材料仕入先と販売先との強いパイプライン（研磨布紙業界と大手自動車部品メーカー）

【今後の展望】

- 受託研磨事業の対象市場拡大（自動車・農機・医療・3Dプリンター業界など）
- Mipoxの営業ネットワークを活用した新規顧客の獲得



2023年4月より本社を東京オフィスから鹿沼事業所に移転し、本格稼働を開始いたしました。
今後、計画的に人員・設備・機械の増強を行いながら、更なる生産能力の拡大に努めてまいります。

【鹿沼事業所】

敷地面積：約60,000㎡
延床面積：約46,000㎡

取得日
2022年4月1日

取得目的

- ・ 受託事業の生産能力拡大
- ・ 事業成長のための場所確保
- ・ BCPの観点から生産体制のリスク分散



受託研磨加工

スリット工程

塗布工程

環境配慮設備

ダイカット工程

物流

鹿沼事業所の稼働状況

- ・ 受託塗布・スリットの稼働を開始
- ・ タイ子会社、京都工場からの生産移転
- ・ (株)スガ コーディングスのIH塗装事業の稼働開始
- ・ 東の物流拠点としての機能を集約
- ・ 使用面積増加も可能（未使用エリアは他社へ貸与中）

研磨ラボの活用

- ・ 顧客と一体で研磨プロセス、製品開発を進められる体制を構築し、初期ニーズの把握を行い、付加価値が高く迅速な製品提供を展開予定



3つのNEDOプロジェクトに参画しております（うち1プロジェクトはすでに終了）。
加工技術と評価技術の確立においてさまざまな組織と協力し、国主導のプロジェクトを進めております。

PROJECT 01

NEDOグリーンイノベーション基金事業 －次世代デジタルインフラの構築－

オキサイドを幹事会社として（株）UJ-Crystal、国立大学法人東海国立大学機構
名古屋大学、アイクリスタル株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所が参画

- 最初の2年の委託事業を当初想定通りの成果で終了し、本年度から助成期間に移行
- 今期はパイロットライン各装置の立上げ・工数削減・シミュレーション技術の構築を目指し、検査装置の量産化検討を実施

加工
技術

大口径SiCウェーハ加工ラインの開発
8インチ対応SiCウェーハ加工、パイロットラインの構築

ウェーハ加工工数の削減
加工シミュレーションの検討と削減工程候補の抽出

評価
技術

溶液法におけるSiC結晶の評価技術確立
溶液法SiCに適した光学系の最適化とそれに基づく装置設計

大口径ウェーハ観察装置の開発
8インチウェーハに対応した装置使用の検討と設計

PROJECT 02

NEDO官民による 若手研究者発掘支援事業

名古屋大学（原田俊太准教授）

- デバイスメーカーとの連携によりデバイス不良との相関を確認し、デバイスキラー欠陥検出もしくはウェーハ品質スクリーニングが可能な量産装置の構築を目指す
- 偏光観察技術の進捗はSiCパワーデバイス製造における品質管理と生産性の向上に貢献しています

評価
技術

半導体製造の生産性を向上させる
キラー欠陥自動検査システムの開発

[2023年8月論文発表](#)

評価
技術

パワーデバイスSiCウエハの偏光観察
による結晶欠陥評価技術

[2024年11月論文発表](#)
[2025年3月論文発表](#) **NEW**

PROJECT 03

NEDOマテリアル革新技術 先導研究プログラム

電力中央研究所・名古屋大学（宇治原徹教授）・理化学研究所

- 2022年度末に終了し、製品化に向けた開発を継続

評価
技術

大型SiC結晶に対する欠陥・
内部歪の観察解析技術

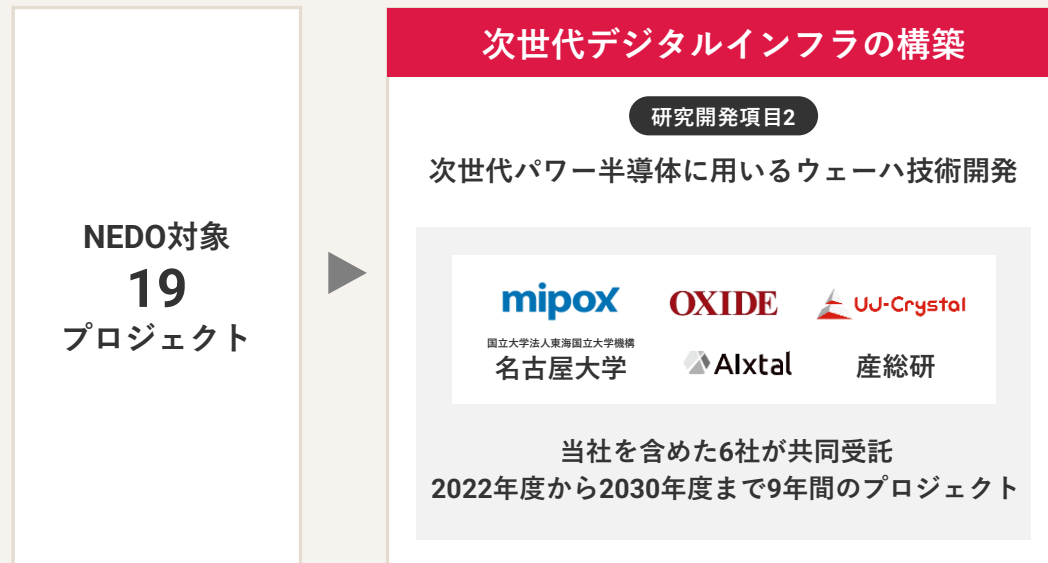
SiCインゴット検査装置の開発

2022年度末
終了

カーボンニュートラルの実現に向けてエネルギー構造や産業構造の転換、大胆な投資によるイノベーションの創出が必要とされています。これまでの社会の延長にない飛躍的な目標を達成するため創出された、グリーンイノベーション基金のプロジェクトに当社が参画しております。

【NEDO※1グリーンイノベーション基金】

- ・ 日本政府が主導する「2050年カーボンニュートラル」宣言を達成するための基金
- ・ 事業予算2兆円
- ・ カーボンニュートラルに向けた研究開発、実証から社会実装に取り組む企業に最長10年間支援

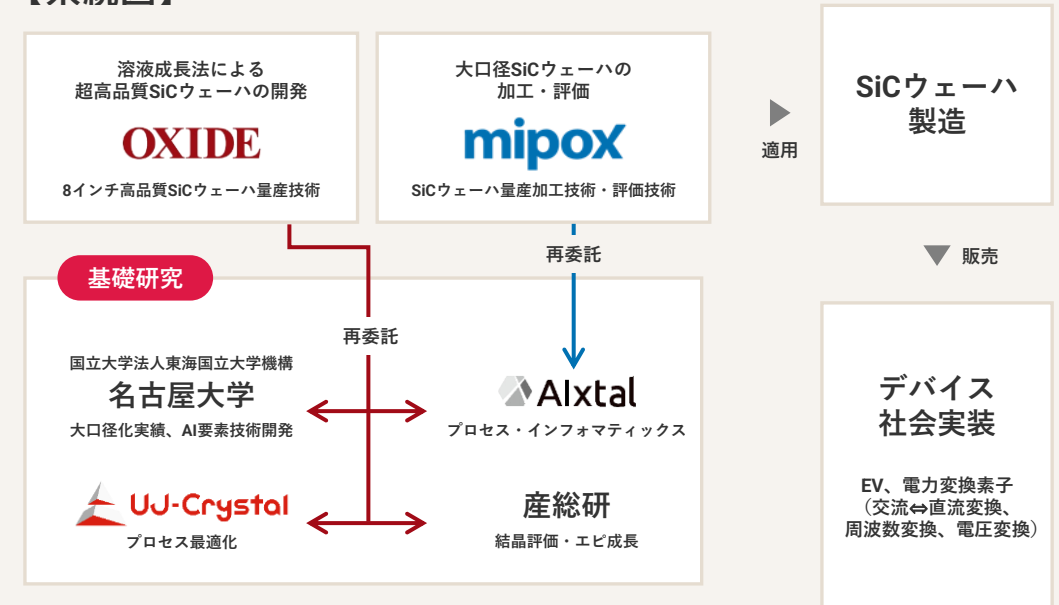


※1：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

【プロジェクトの目的】

超高品質・8インチ・低コストSiCウェーハ開発・販売

【系統図】



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期
通期実績

FY2025 Full Year Financial Results

03

2026年3月期
業績見通し

FY2026 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

変わることを忘れない 『100年ベンチャー』

当社は1925年にドイツ・レイボルト商館の子会社として創業し、輸入した顔料を販売する傍ら主に出版物に使われる色箔の製造を生業としておりました。1960年代後半よりこの色箔を製造する中で培った「塗る」技術、それを裁断する「切る」技術を基に、精密部品の製造工程事業に使用される研磨フィルムを開発し、「塗る・切る・磨く」の3つのコア技術を確立いたしました。

精密研磨材専門メーカーとして発展を経て、2000年初頭からはコア技術である『塗る』をサービスとして提供するエンジニアリングサービス（受託塗布）を開始いたしました。創業来の危機である2008～2010年を乗り越えたあとは、『磨く』をサービスとして提供するウエハープロセス（受託研磨）を立ち上げ、「塗る・切る・磨くで世界を変える」に取り組んでまいりました。2016年には研磨布紙メーカーである日本研紙を仲間に加え、製品事業のラインナップの拡充を進めました。

創業から間もなく100年。事業を長く続けていくために、急速に変化するテクノロジーや世の中の価値観を敏感にとらえながら、自らも変化に順応していくことが求められます。こうした時代のニーズに対応するため、わたしたちが培ってきたコア技術をさらに高めながら、新しい事業にも積極的にチャレンジし、世の中に必要とされる製品やサービスを通じて世界のお客様に選ばれるパートナーを目指してまいります。

変わることを忘れない、『100年ベンチャー』を目指してこれからも変化し続ける集団でありつづけます。

今後とも皆様のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長 渡邊 淳



01



代表取締役社長 渡邊 淳 WATANABE Jun

日本とアメリカの大学で学んだ後、1994年当社へ入社。製造現場でキャリアをスタートし、生産技術、国内営業、海外営業を担当後マレーシア駐在員、米国子会社赴任を経験。その後半導体部門長、海外支援部門長に従事。2007年取締役、2008年に先代から引き継ぐ形で現職に就任。就任後は不採算事業撤退や拠点の統廃合を通して赤字からの脱却を行った。業績回復後は製造業として「技術・品質」に加え、デジタルを企業変革の柱と据えてIT推進をリード。

02



取締役 中川 健二 NAKAGAWA Kenji

全自動水洗い洗濯機や半導体CMP後洗浄装置の開発、ハードディスクメディアむけ研磨テープや光学検査装置の技術営業を経験。独立後は光学検査装置のマーケティングから技術、営業や貿易などに携わる。2002年に独立後、2016年当社技術本部長、2019年経営企画部長兼経営管理部長に就任。経営全般に関わりながら、社内組織体制の構築やレフタイトのリブランディング活動に注力。2021年から新事業開発に携わり、GI基金の大口径SiCウェーハの加工開発を統括している。

03



取締役 上谷 宗久 UETANI Munehisa

2000年に当社入社。台湾支店長や海外子会社の代表取締役を経て、2012年取締役営業本部長に就任。製造拠点の運営、競合他社とのM&A、そして民事再生を経た企業の事業承継等を担当。2017年に退職し、ITベンチャーにおける取締役COOとしての経験をはじめ、エンジニアリング企業での事業開発責任者としての役職を経た後に、2022年4月に当社に復帰。外部活動としてthomas株式会社の社外取締役も務める。

04



社外取締役（独立役員）長井 正和 NAGAI Masakazu

長瀬産業にて1973年から半導体を中心とする精密電子回路製造用機材の海外営業に25年間従事。1988年から6年間シリコンバレーに駐在し、三次元半導体パッケージ設計技術の日米企業間コラボを推進。2003年に独立し、トランスエッジ有限会社の代表として現在に至るまで主に半導体・回路板の技術・マーケティングのコンサルティングに従事。

05



社外取締役（独立役員）加藤 洋美 KATO Hiromi

2007年12月に弁護士登録をし、日比谷法律事務所に入所。以降、法律業務に従事し、2021年4月には同事務所の所長に就任。現在も所長として業務を遂行中。また、2021年4月からは小岩井農牧株式会社の監査役を務めており、2023年4月には株式会社小岩井ファームダイニングの監査役にも就任し、同様に現任している。

		経営全般	グローバル 経営	ESG	DX戦略	財務・会計	研究・ 技術開発	M&A	マーケティ ング・営業	製造・ 生産技術	法務・リスク マネジメント
01	 代表取締役社長 渡邊 淳	●	●	●	●			●		●	
02	 取締役 中川 健二						●		●	●	
03	 取締役 上谷 宗久		●		●			●	●		
04	 社外取締役（独立役員） 長井 正和	●	●				●		●		
05	 社外取締役（独立役員） 加藤 洋美										●

当社では、次世代を担う人材の育成と長期的なキャリア形成を重視しています。そのため、以下のような多様な取り組みを行っています。

採用や育成に関する取り組み

【工場見学およびインターンシップ】

高校生を対象に工場見学やインターンシップを実施し、職業体験を通じて実際の業務を理解してもらう機会を提供しています。これにより、若い世代の興味を引き出し、将来の採用につなげています。

【OJT教育と研修制度】

当社の教育プログラムはOJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を中心に構成されています。新入社員は現場での実務経験を積むことで、実践的なスキルを身につけます。また、各部署やキャリアパスに応じてフォローアップ研修を行い、継続的な成長を支援しています。具体的な研修内容としては、入社時研修、拠点間研修、ビジネススキル研修（外部研修）などがあります。

【新卒定着率】

当社の**新卒定着率※は80.0%**と高く、これは充実した研修制度と働きやすい環境が実現されている証です。新入社員が長期にわたり安心して働けるよう、支援体制を整えています。

※過去5年採用新卒定着率。国内データに基づく。

※2025年3月末現在



新卒定着率 **80.0%**

当社では、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、柔軟で多様な働き方を推進しています。



平均残業時間
11～15時間/月

男性育休取得率 **80.0%**

働き方に関する取り組み

【在宅勤務とスーパーフレックス制度】

働く場所や時間に柔軟性を持たせることで、従業員が自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようにしています。

【ハレアワー制度】

社員がリフレッシュし、仲間との絆を深めるために、時間単位で取得できる休暇制度です。具体的な活動例としては、部や課の全員でプロスポーツの応援に行く、花見や暑気払いを行う、打ち合わせ後に全員でボーリングに行くなどが含まれます。この制度は社員全員がリフレッシュし、良好な人間関係を築くことを目的としています。

【地域貢献活動】

小中学生を対象とした「研磨加工教室」の開催や定期的な公園美化活動の実施等を通して、地域社会への貢献を大切にしています。

【社内行事】

当社が大切にしている『みんな仲良く』の精神を実現するため、また「働き方改革」の一環として、社内行事を積極的に実施しています。これにより、社員間のコミュニケーションが深まり、より良いチームワークが築かれています。

【残業時間の管理】

当社の従業員の**平均残業時間は年間で12.4時間、月11～15時間***を推移しています。具体的な目標数値は持っていませんが、バランスの取れた働き方を重視しています。

【有給休暇取得率】

有給取得率の**目標を80%**と設定しており、現状では**92.1% ***です。これにより、従業員のワークライフバランス向上を図っています。また、**男性育休取得率は80.0% ***となっております。

当社では、従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある職場環境を実現するために、以下の取り組みを行っています。

エンゲージメントに関する取り組み

【COMPASSの作成】

当社の指針となる「**COMPASS**」を作成し、全従業員に共有しています。この指針は、企業理念やビジョン、行動指針を明確にし、従業員が日々の業務において共通の目標と価値観を持つための基盤となっています。

【定期的なアンケートの実施】

従業員の声を直接反映させるために、定期的に従業員サーベイ（ウェルビーイングサーベイ）を実施しています。このアンケートでは、従業員の満足度や不満点を収集し、それに基づいた具体的な対策を講じています。従業員の意見を積極的に取り入れることで、働きやすい環境の整備とエンゲージメント向上を図っています。

これらの取り組みの結果として、当社の**退職率は6.9%（グローバル）**となっており、従業員が長く安心して働ける環境が整っています。これからも、従業員の声大切に、エンゲージメント向上に努めてまいります。



退職率 **6.9%**

当社では、安全と適正を最優先に考え、職場環境の最適化に向けた取り組みを積極的に行っています。



5S活動

健康・安全に関する取り組み

【5S活動】

5つの要素からなる5S活動を推進しています。これにより、職場の安全性を向上させ、効率的な作業環境を整えています。

◆ 5Sとは

- | | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 整理 | Seiri | ： いらないものを捨てる |
| 整頓 | Seiton | ： 決められたものを決められた場所に置き、取り出せる状態にしておく |
| 清掃 | Seisou | ： 常に掃除する |
| 清潔 | Seiketsu | ： 3S（整理、整頓、清掃）を維持し、職場の衛生を保つ |
| 躰 | Shitsuke | ： 決められたルールを守る、手順を正しく守る、習慣をつける |

当社は生産性向上のための業務効率化を行っています。
安全性、快適性の高い工場を目指し、決められたルールを当たり前を守る風土を作り、会社の信用度、会社の利益に繋がります。
安全で安心して働ける職場環境の維持と向上に努めています。

当社では、多様性を尊重し、誰もが活躍できる職場環境の実現に向けた取り組みを進めています。

ダイバーシティに関する取り組み

【男女別従業員比率】

従業員比率は**男性：女性が3.6：1（グローバル）**となっています。これに対して、女性の採用や昇進の機会を増やす取り組みを進めています。

【男女別賃金格差】

男女間の賃金格差は61.8%（国内のみ）です。なお、属性（勤続年数、役職等）が同じ男女労働者間での賃金の差異はありません。

【女性管理職比率】

女性管理職比率は11.4%（グローバル）です。女性リーダーの育成プログラムやメンター制度を導入し、女性が管理職として活躍できる環境作りを推進しています。

【障がい者雇用比率】

障がい者雇用比率は1.8%（国内のみ）であり、目標の2.7%（2026年までに）に向けて取り組んでいます。職場のバリアフリー化や障がい者向けの職務設計を進めることで、働きやすい環境を整備しています。



男女間の賃金格差 **61.8%**

女性管理職比率 **11.4%**

障がい者雇用比率 **1.8%**

Environment



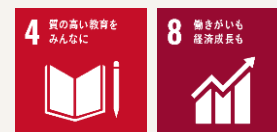
- 太陽光パネル導入の推進
- IH 粉体塗装システム
- RTOの利用によるVOC削減
- LNGボイラの導入
- リサイクル素材を使用した製品の開発
- グリーンイノベーションへの取り組み
- ISO14001 にもとづいた環境負荷軽減



Social



- Eラーニングによる社内教育の充実
- スーパーフレックスタイムの導入
- 人事評価システムの構築
- 資格取得の促進および取得後の手当の充実
- 労働災害事故の防止
- 若手の定着率の向上
- 女性従業員比率の向上



Governance



- 透明性のある情報開示
- 内部通報窓口を外部企業に委託
- 全社員に対するコンプライアンス研修の実施
- グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制の強化



● 工場/オフィス ● 営業拠点



IRお問い合わせ

フェアディスクロージャーの観点から、公平な情報開示体制と株主様と投資家の皆様へのお問合せ対応の維持を考慮し、IRお問い合わせ窓口のお電話での対応をおこなっておりません。HPのお問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせはこちら ➤

<https://www.mipox.co.jp/inquiry.html>



mipox



Ref Lite
Color Your Style.

